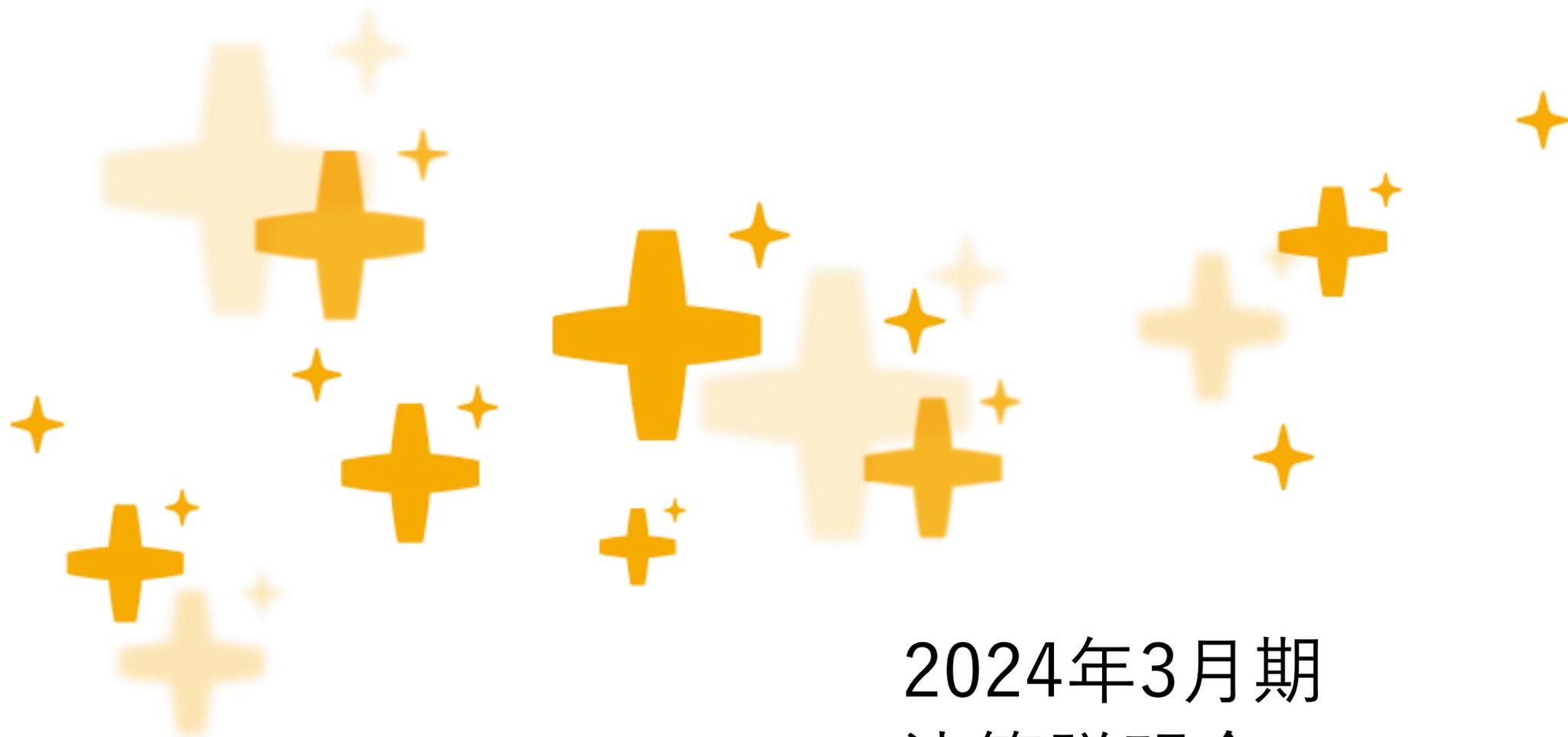


新たな可能性をプラスし、輝く未来へ。



2024年3月期 決算説明会 (2024年5月15日)

代表取締役 社長執行役員 小林 和也

本日の内容

1. 2024年3月期 連結決算の概要
2. 2025年3月期 連結業績予想
3. 中期経営計画の進捗状況
4. 資本コストや株価を意識した経営の実現について



1. 2024年3月期 連結決算の概要

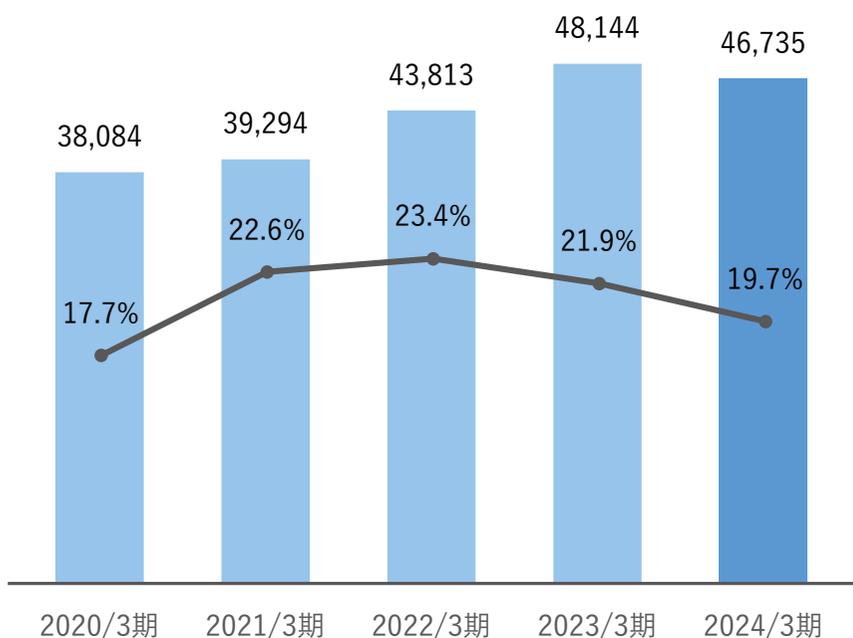
2024年3月期連結決算 ハイライト

POINT 半導体分野の落ち込みにより、
4期ぶりの減収

売上高

前期比
-2.9%

■ 売上高(百万円)
● 営業利益率

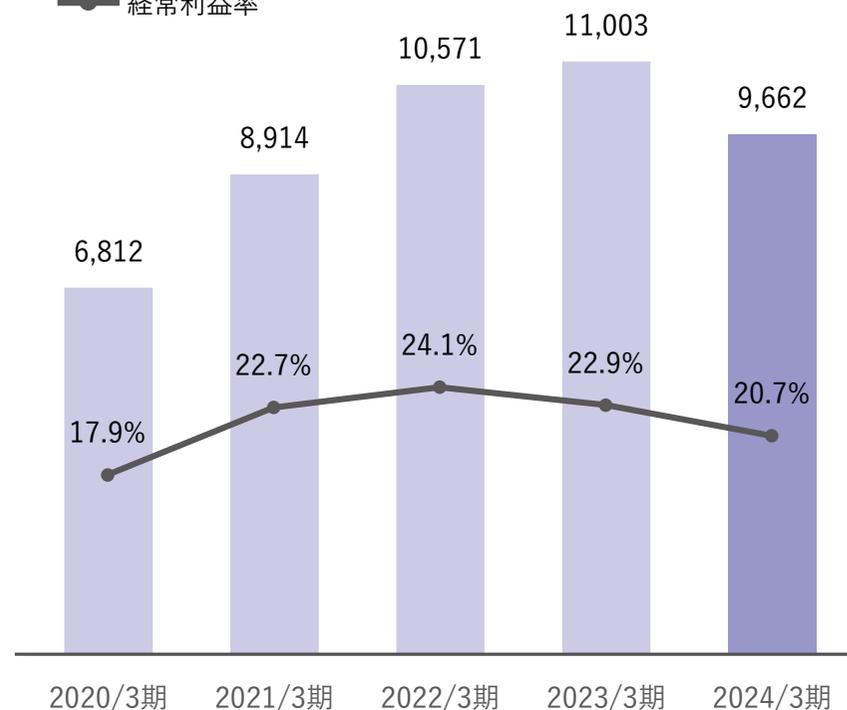


POINT 経常利益は前期比12.2%減となるも、
期初予想 (87億円) を上回った

経常利益

前期比
-12.2%

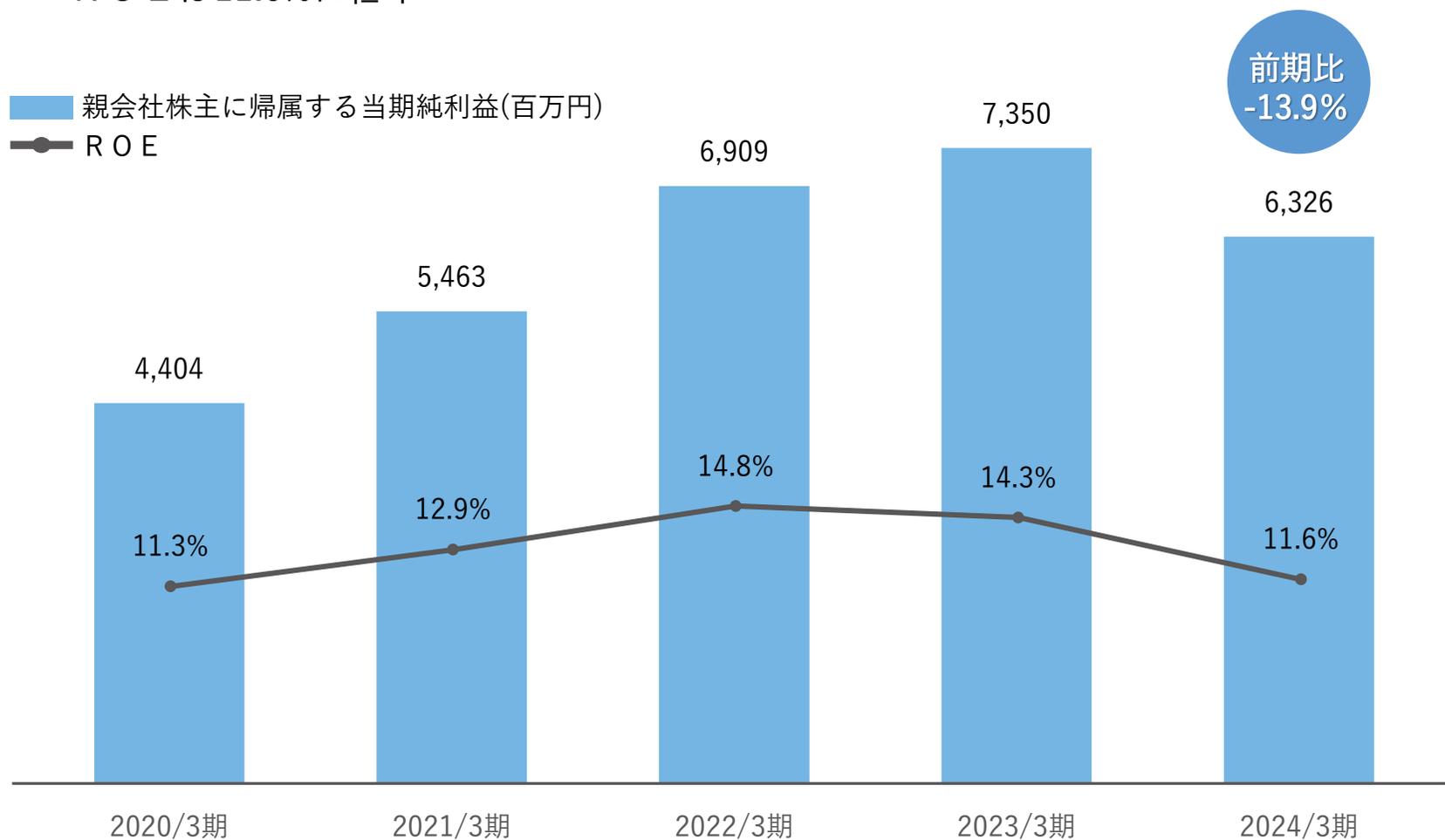
■ 経常利益(百万円)
● 経常利益率



2024年3月期連結決算

親会社株主に帰属する当期純利益とR O E

POINT 親会社株主に帰属する当期純利益は前期比13.9%減
R O E は11.6%に低下



2024年3月期 連結決算の概要

- 売上高は、半導体分野の落ち込みを他の分野で補うには至らず前期比2.9%減
- 経常利益は、利益率の高い半導体分野の売上減少により同12.2%減

(百万円)	2023/3期		2024/3期		前年同期比増減	
	実績	構成比	実績	構成比	金額	率
売上高	48,144	100.0%	46,735	100.0%	△1,408	-2.9%
営業利益	10,558	21.9%	9,197	19.7%	△1,361	-12.9%
経常利益	11,003	22.9%	9,662	20.7%	△1,341	-12.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	7,350	15.3%	6,326	13.5%	△1,023	-13.9%
1株当たり当期純利益 (EPS)	120.83円	—	105.53円	—	△15.30円	—

2024年3月期 売上高 (分野別)

- 半導体・F P D分野の落ち込みにより、最大セグメントの溶射加工(単体)が減収
- 農業機械部品向けが増加したその他表面処理加工をはじめ、他のセグメントは好調に推移

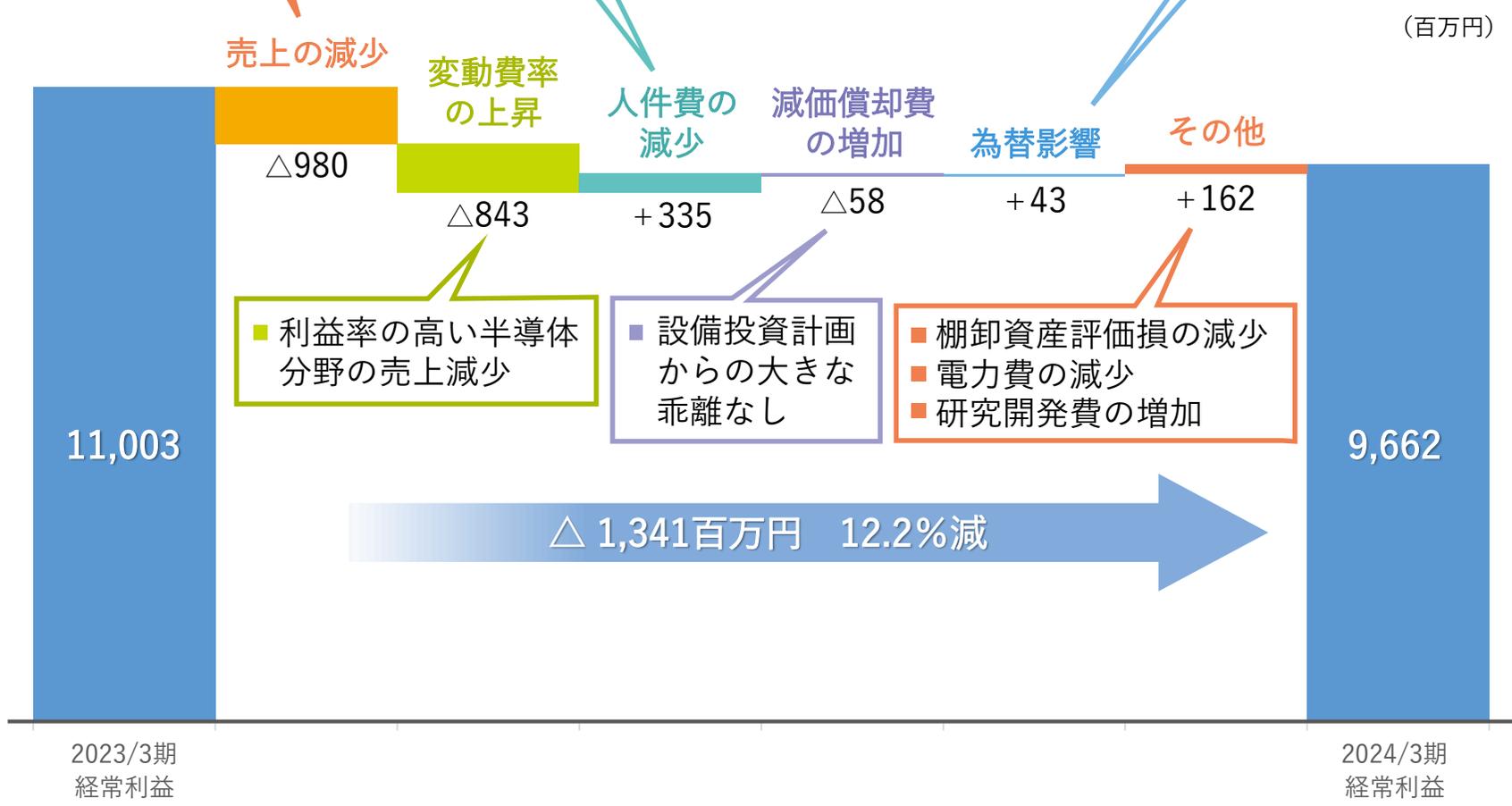
(百万円)	2023/3期		2024/3期		前年同期比増減	
	実績	構成比	実績	構成比	金額	率
売上高	48,144	100.0%	46,735	100.0%	△1,408	-2.9%
■ 溶射加工(単体)	36,184	75.2%	33,859	72.4%	△2,324	-6.4%
半導体・F P D	23,260	48.3%	19,557	41.8%	△3,702	-15.9%
産業機械	3,802	7.9%	4,923	10.5%	1,121	29.5%
鉄鋼	3,582	7.4%	3,651	7.8%	68	1.9%
その他	5,539	11.6%	5,727	12.3%	187	3.4%
■ その他表面処理加工	2,745	5.6%	3,019	6.5%	273	10.0%
■ 国内子会社	2,414	5.0%	2,457	5.3%	42	1.8%
■ 海外子会社	6,622	13.8%	7,257	15.5%	635	9.6%
受取ロイヤリティー等	177	0.4%	141	0.3%	△35	-20.0%

前年同期比 経常利益 増減要因分析

- 溶射加工(単体)の受注減少
- 販売価格値上げで一部を補った

- 退職給付会計による数理計算上の差異の一括償却影響を除くと △156百万円
- 賃上げの実施、正社員の増加など

- 円安が進行し利益押し上げ



- 利益率の高い半導体分野の売上減少

- 設備投資計画からの大きな乖離なし

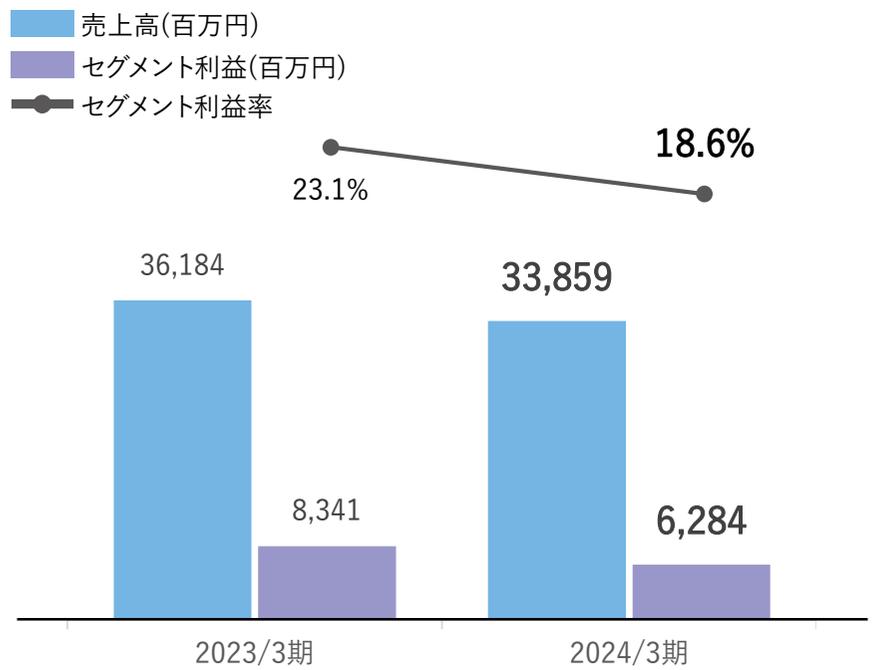
- 棚卸資産評価損の減少
- 電力費の減少
- 研究開発費の増加

2024年3月期連結決算 セグメント別

溶射加工(単体)

産業機械およびその他分野は好調に推移するも、半導体・FPD分野の落ち込みにより、減収減益

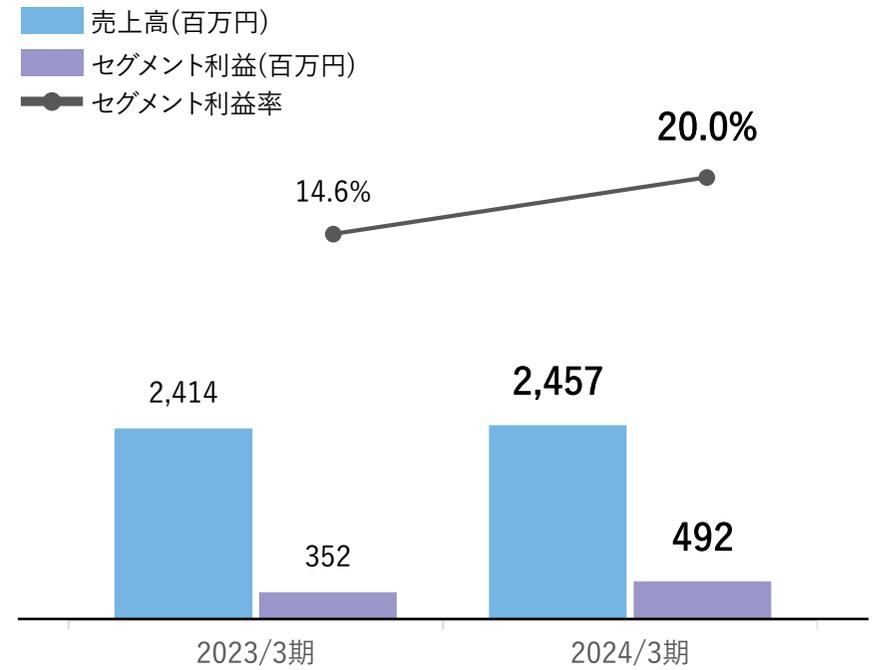
前年同期比増減率
 売上高 …………… △6.4%
 セグメント利益 …… △24.6%



国内子会社

自動車生産の改善で切削工具関係の受注が持ち直し、増収増益

前年同期比増減率
 売上高 …………… +1.8%
 セグメント利益 …… +39.7%

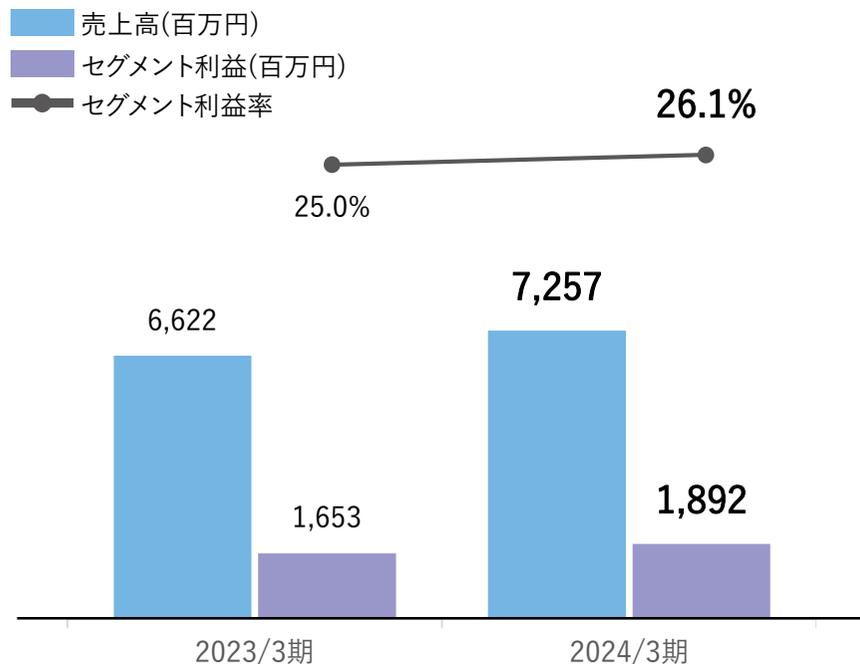


2024年3月期連結決算 セグメント別

海外子会社

中国で半導体関連の売上が伸び悩んだものの、
その他は堅調に推移し、増収増益

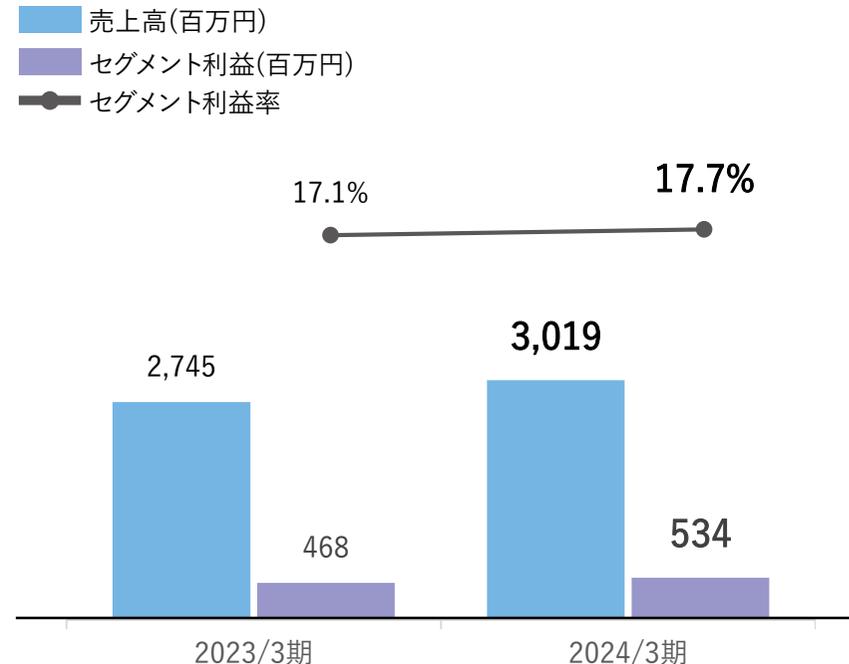
前年同期比増減率
 売上高 …………… +9.6%
 セグメント利益 … +14.4%



その他表面処理加工

農業機械部品向けの受注が増加し、増収増益

前年同期比増減率
 売上高 …………… +10.0%
 セグメント利益 … +14.2%



セグメント情報

- 溶射加工(単体) は、半導体分野の売上減少により利益が大幅減
- 国内子会社は、主力の切削工具関係の受注が持ち直し利益伸長
- 海外子会社は、半導体関連売上が伸び悩んだものの、その他は堅調に推移し増収増益

(百万円)	2023/3期		2024/3期		前年同期比増減			
	売上高	セグメント利益	売上高	セグメント利益	売上高		セグメント利益	
					金額	率	金額	率
■ 溶射加工(単体)	36,184	8,341	33,859	6,284	△2,324	-6.4%	△2,056	-24.6%
■ 国内子会社	2,414	352	2,457	492	42	1.8%	139	39.7%
■ 海外子会社	6,622	1,653	7,257	1,892	635	9.6%	238	14.4%
■ その他表面処理加工	2,745	468	3,019	534	273	10.0%	66	14.2%
合 計	47,966	10,815	46,593	9,204	△1,372	-2.9%	△1,610	-14.9%

(注) 売上高のうち「受取ロイヤリティー等」は含まれておりません。

財政状態

- 総資産は、前期末比36億円の増加（有形固定資産の増加20億円）
- 自己資本比率は、前期末比1.3ポイント低下の71.2%
- 有利子負債は、前期末比22億円の増加

(百万円)	2023/3期	2024/3期
	4Q末	4Q末
総資産	74,263	77,940
自己資本	53,839	55,460
自己資本比率	72.5%	71.2%
有利子負債残高	2,802	5,002

キャッシュ・フローの状況

- 当期のフリーキャッシュ・フロー（営業CF + 投資CF）は+32億円
- 投資CF / 有形固定資産の取得 前期：△46億円 当期：△47億円
- 財務CF / 配当金の支払額 前期：△28億円 当期：△31億円
 自己株式の取得 前期： — 当期：△20億円

(百万円)	2023/3期 通期	2024/3期 通期
営業キャッシュ・フロー	9,894	7,877
投資キャッシュ・フロー	△ 5,094	△ 4,634
財務キャッシュ・フロー	△ 4,561	△ 3,241
現金及び現金同等物の期末残高	19,520	19,656

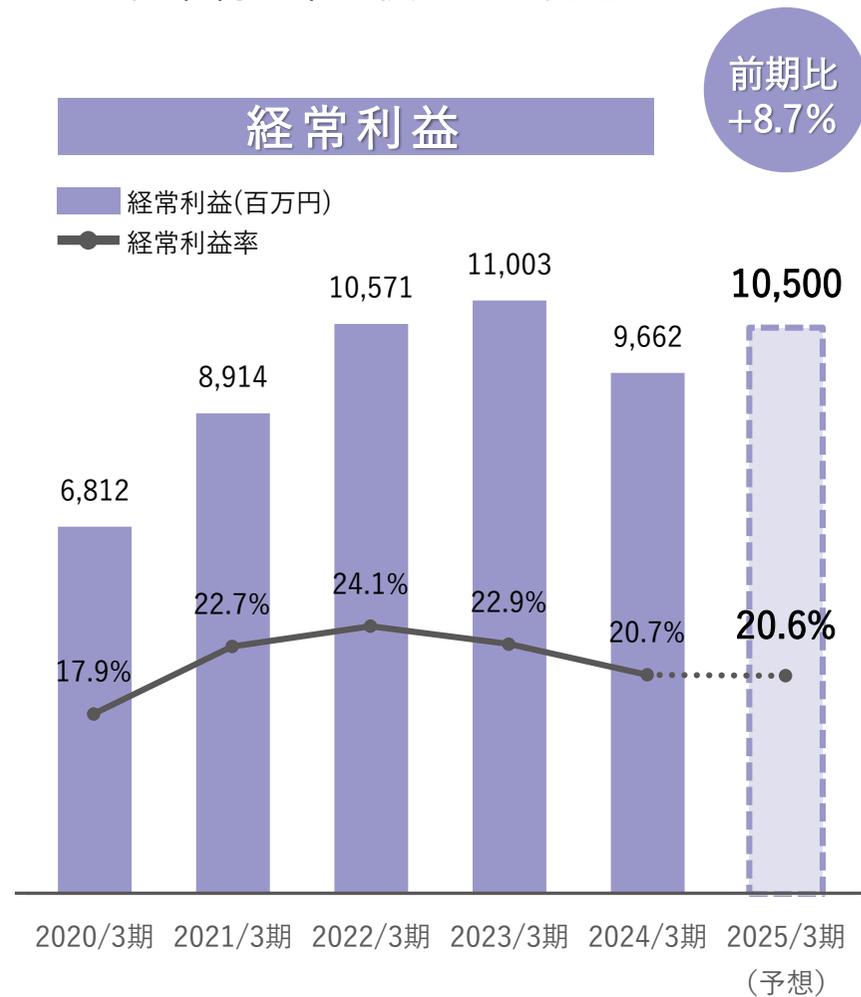
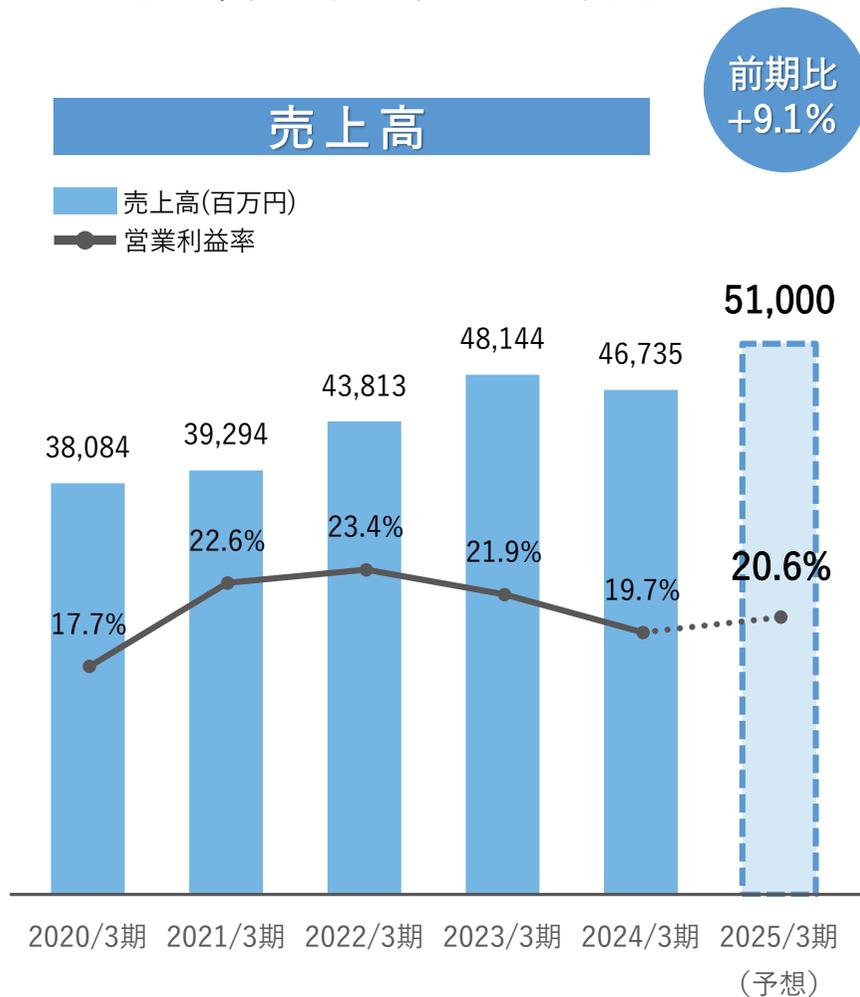


2. 2025年3月期 連結業績予想

売上高と経常利益の見通し

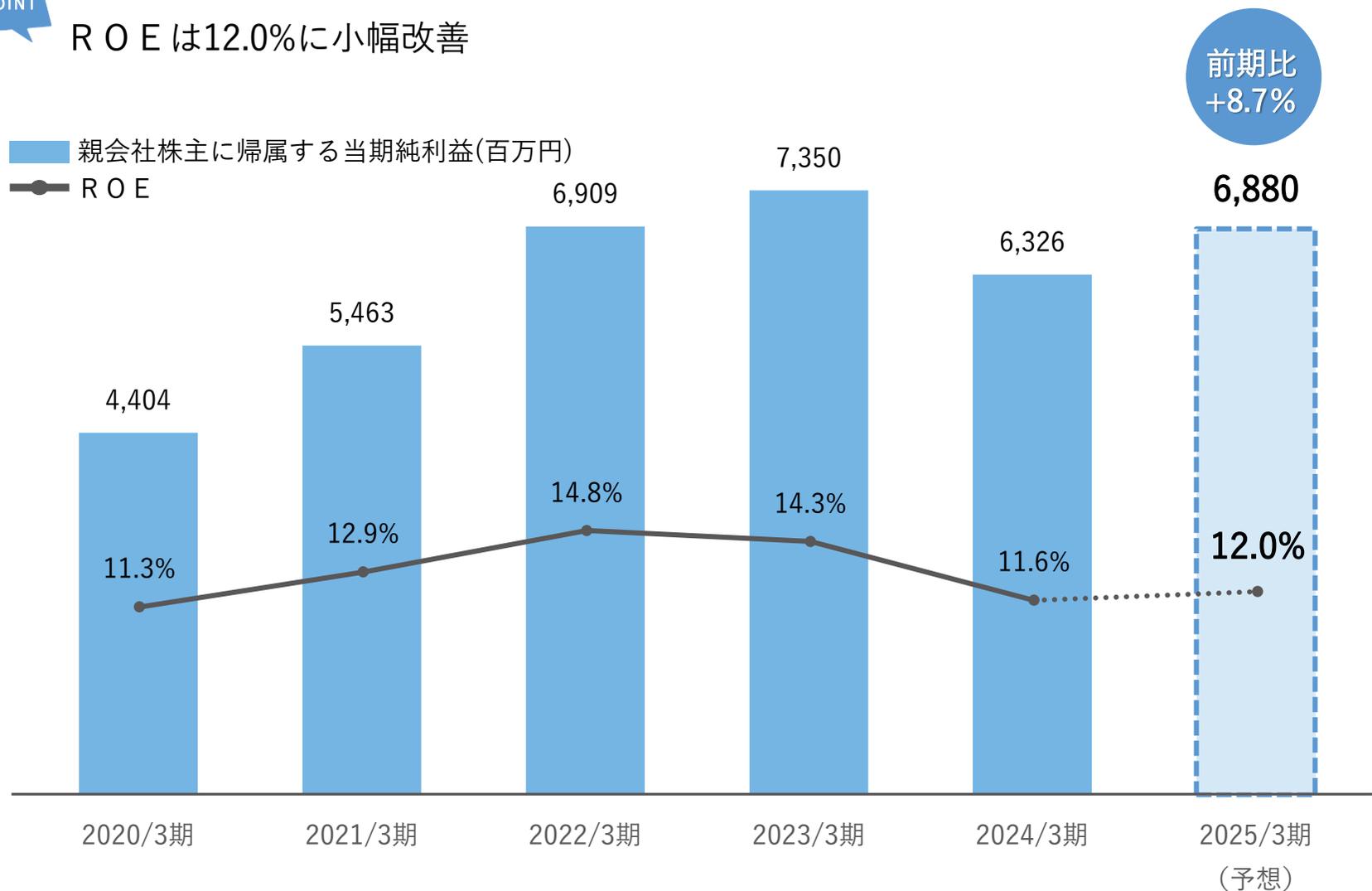
POINT 半導体分野の回復により、
過去最高の売上高となる見込み

POINT 人件費増加を含む製造原価上昇により、
経常利益率は横ばいの見通し



親会社株主に帰属する当期純利益と R O E の見通し

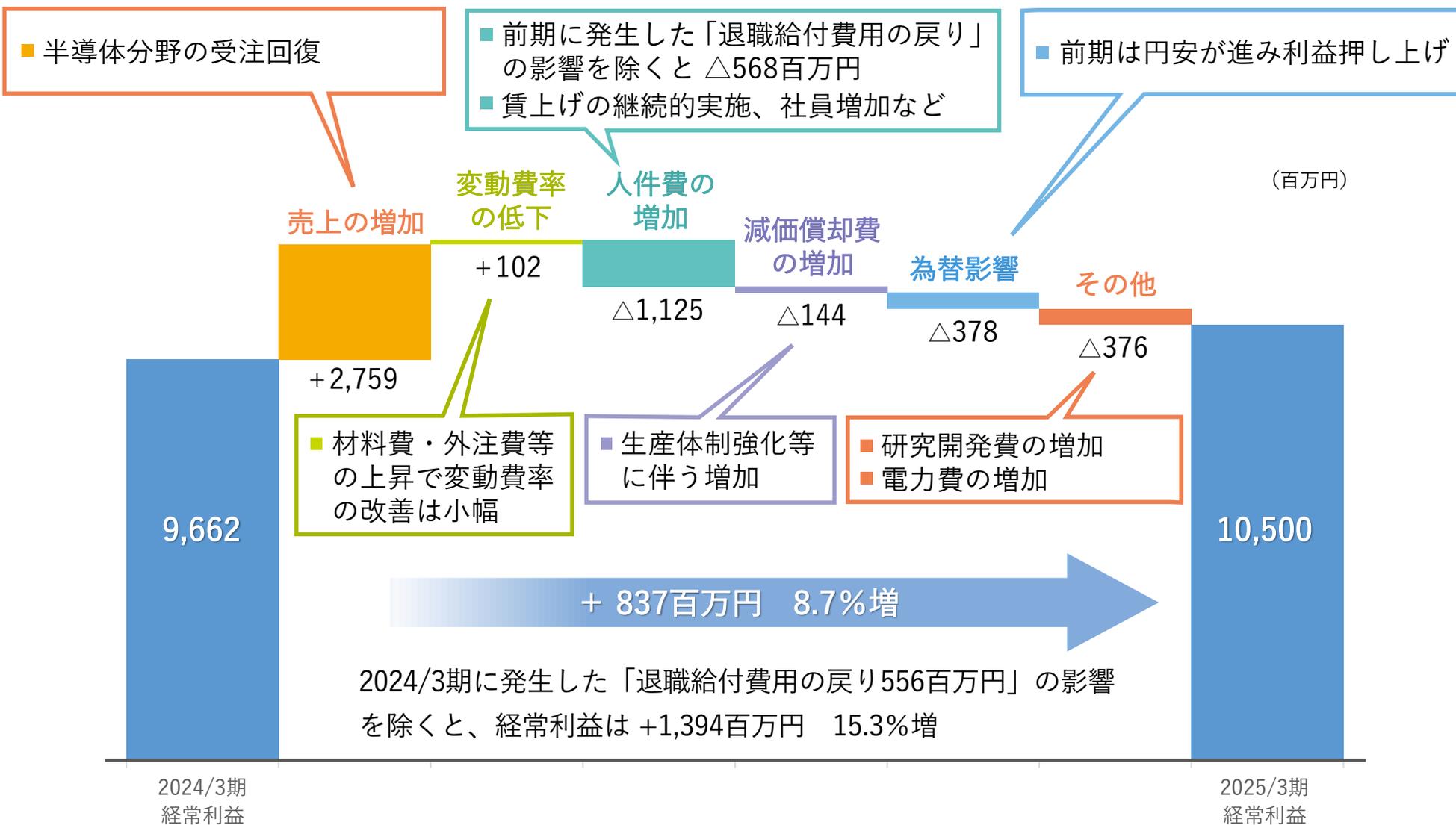
POINT 親会社株主に帰属する当期純利益は前期比8.7%増
R O E は12.0%に小幅改善



2025年3月期 連結業績予想

(百万円)	2024/3期 通期		2025/3期 通期		前期実績比増減	
	実績	構成比	予想	構成比	金額	率
売上高	46,735	100.0%	51,000	100.0%	4,264	9.1%
■ 溶射加工(単体)	33,859	72.4%	37,632	73.8%	3,773	11.1%
半導体・F P D	19,557	41.8%	23,005	45.1%	3,447	17.6%
産業機械	4,923	10.5%	4,603	9.0%	△320	-6.5%
鉄鋼	3,651	7.8%	4,037	7.9%	385	10.6%
その他	5,727	12.3%	5,987	11.8%	260	4.6%
■ その他表面処理加工	3,019	6.5%	2,738	5.4%	△281	-9.3%
■ 国内子会社	2,457	5.3%	2,708	5.3%	250	10.2%
■ 海外子会社	7,257	15.5%	7,771	15.2%	513	7.1%
受取ロイヤリティー等	141	0.3%	150	0.3%	8	5.8%
営業利益	9,197	19.7%	10,500	20.6%	1,302	14.2%
経常利益	9,662	20.7%	10,500	20.6%	837	8.7%
親会社株主に帰属する当期純利益	6,326	13.5%	6,880	13.5%	553	8.7%
1株当たり当期純利益 (EPS)	105.53円	—	115.75円	—	10.22円	—
自己資本利益率 (ROE)	11.6%	—	12.0%	—	0.4pt	—

連結業績予想 経常利益 増減要因分析



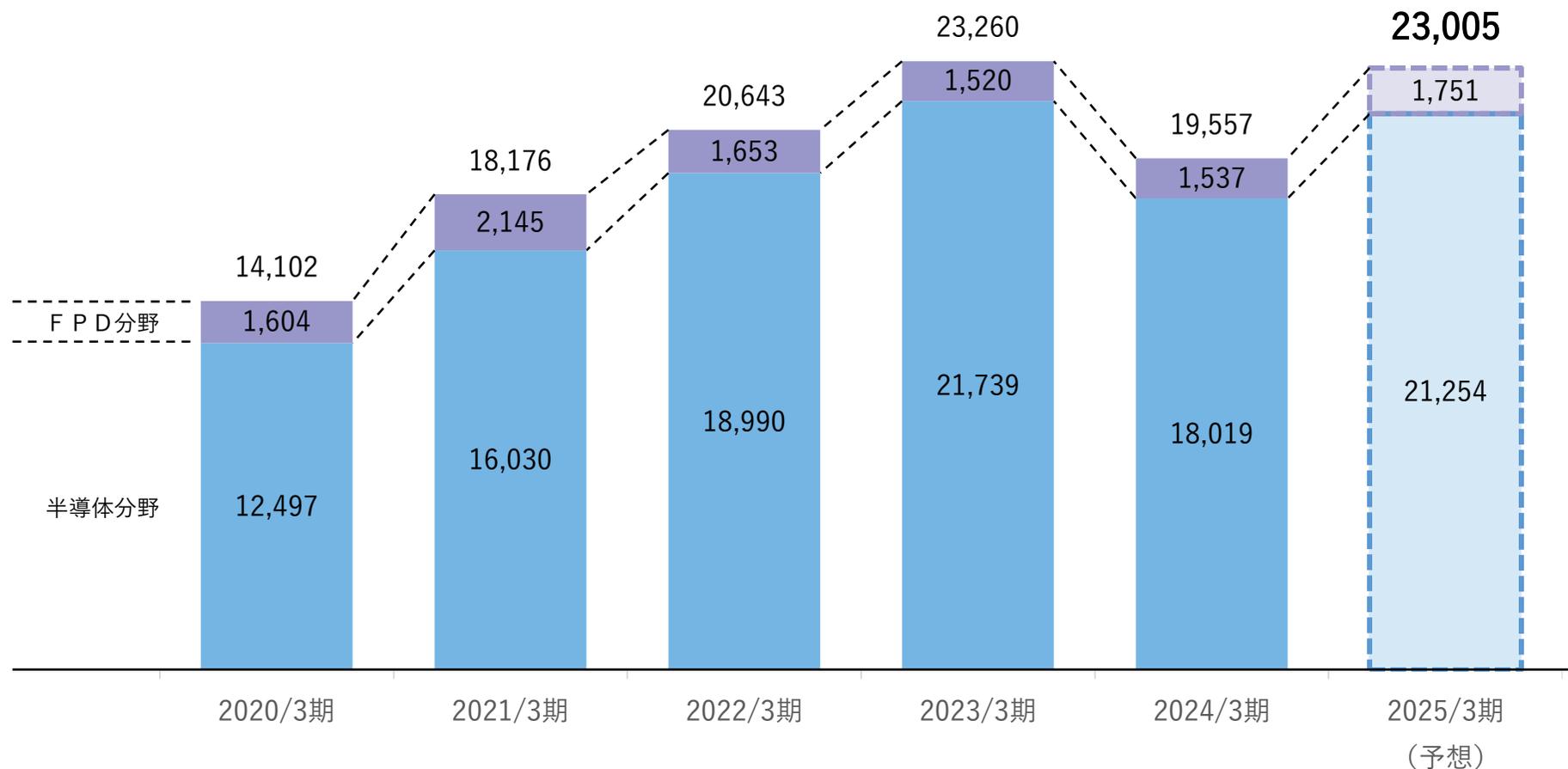
半導体・FPD分野の売上推移



半導体業界が回復局面を迎えており、在庫調整は間もなく一巡し
当社の受注も段階的に回復する見通し

前期比
+17.6%

(百万円)



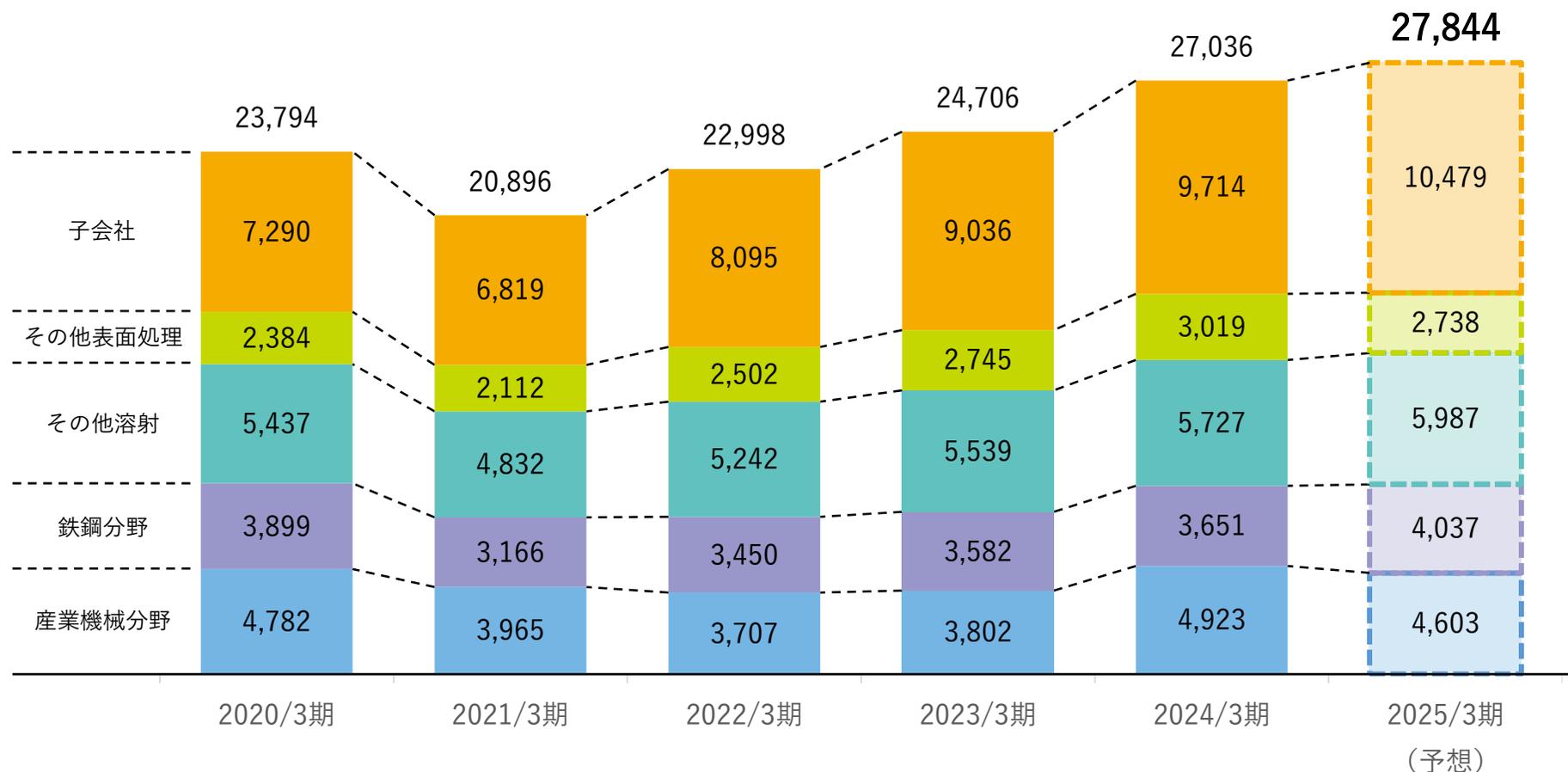
半導体・F P D分野以外の売上推移



半導体・F P D分野以外の売上高は、前期比3.0%増を見込む
産業機械分野は、前期好調の発電設備向けメンテナンスが反動減

前期比
+3.0%

(百万円)



(注) 売上高のうち「受取ロイヤリティ等」は含まれておりません。

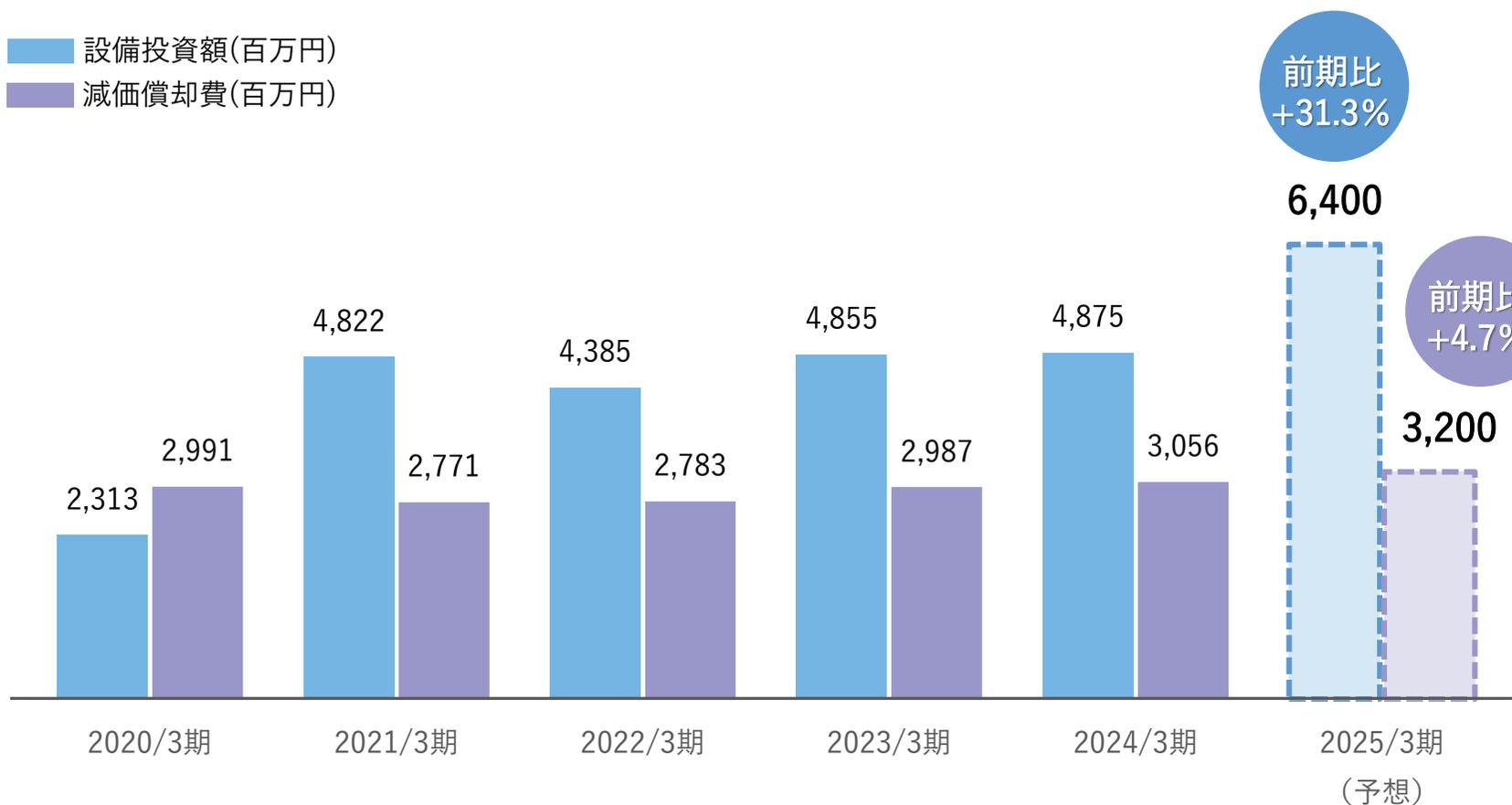
設備投資額と減価償却費

POINT

2025年3月期の設備投資予定額 64億円

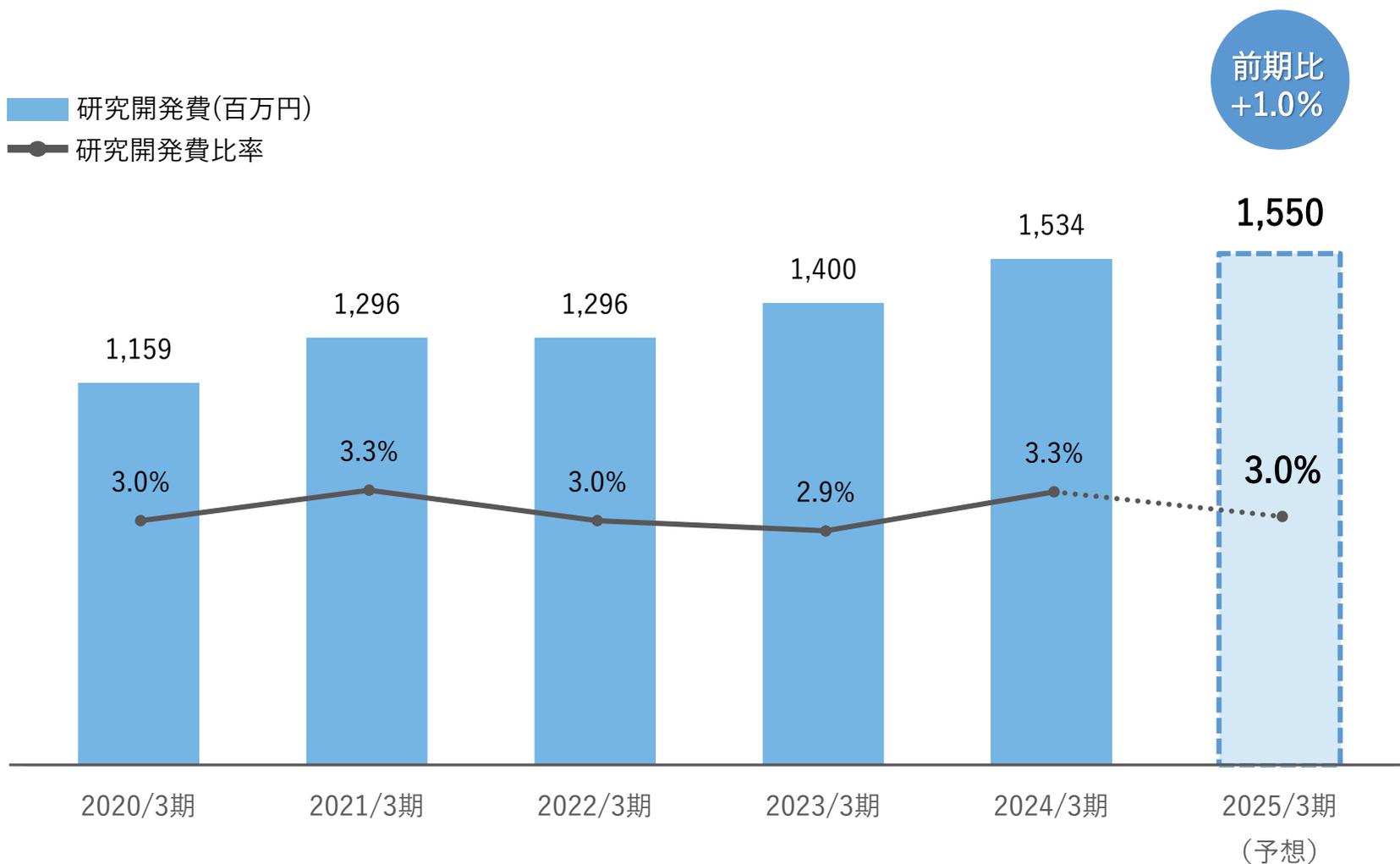
- トーカロ 50億円：神戸工場新棟建設、増産対応・生産効率化、研究設備増強など
- 国内子会社 4億円：生産能力増強など
- 海外子会社 10億円：東賀隆(昆山)・漢泰国際電子(台湾)での新工場立ち上げなど

■ 設備投資額(百万円)
■ 減価償却費(百万円)



研究開発費

POINT 研究開発費は連結売上高比で3%程度を維持



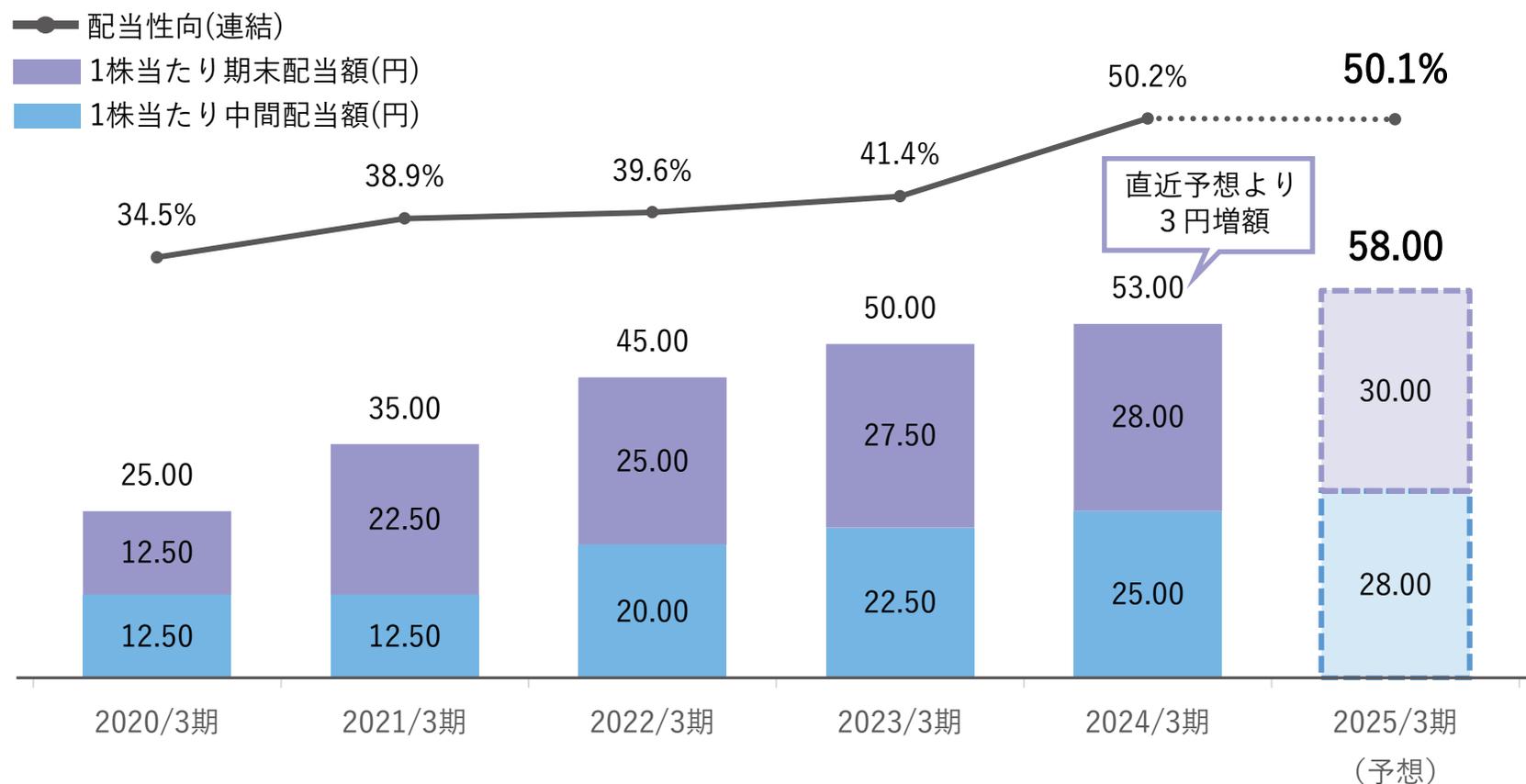
1株当たり配当額と配当性向の推移



2025年3月期の年間配当は 58円 (配当性向 50.1%) を予定

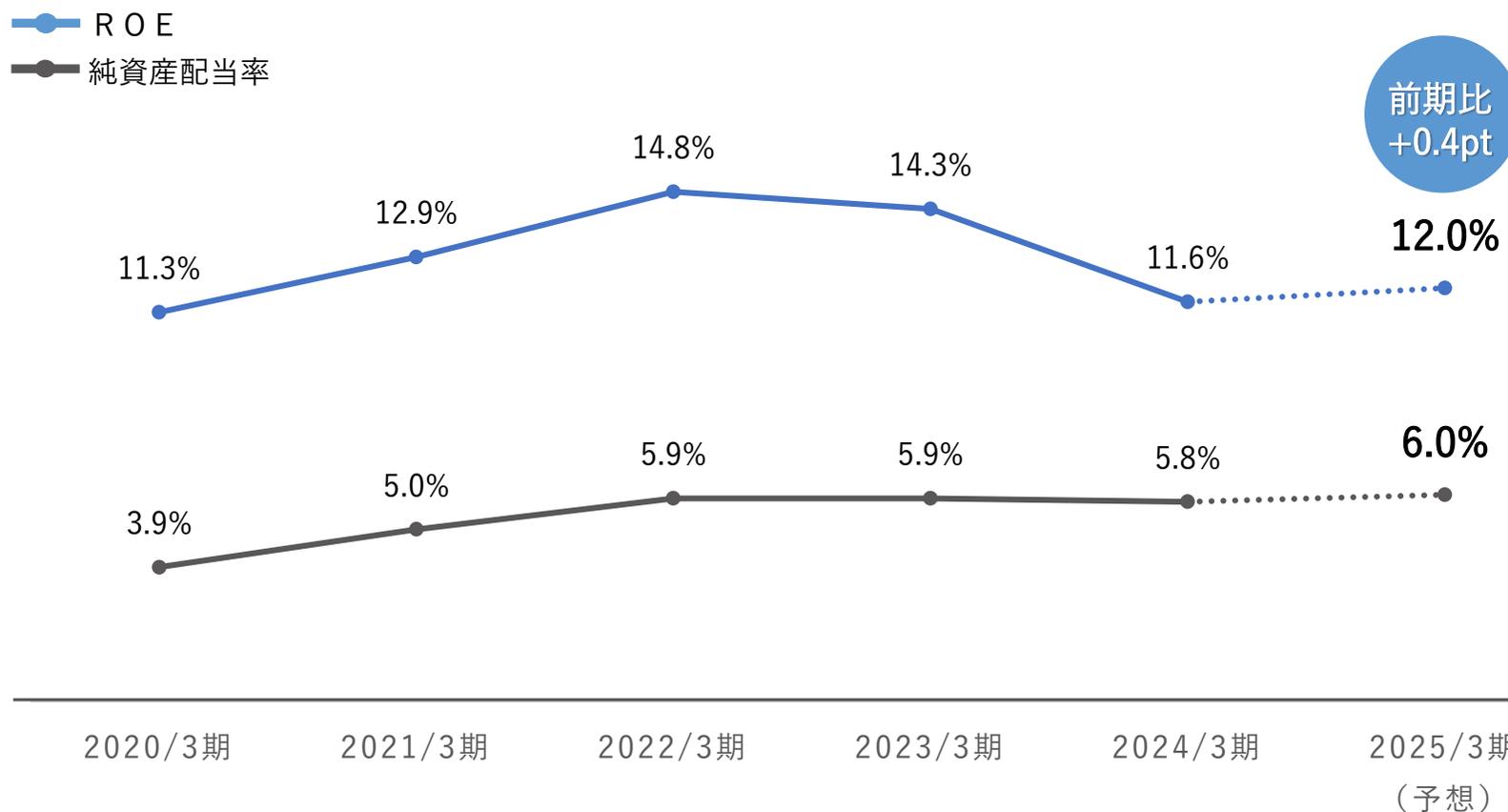
株主還元方針

- 連結配当性向 50%程度および純資産配当率 (DOE) 5%以上を目標とする
- 自己株式の取得も、事業環境や財務状況などを考慮しつつ機動的に実施



ROEと純資産配当率の推移

POINT ROE※の改善に伴い、純資産配当率※は6%程度となる見込み



※ROE (自己資本利益率) = 当期純利益 / 期中平均自己資本

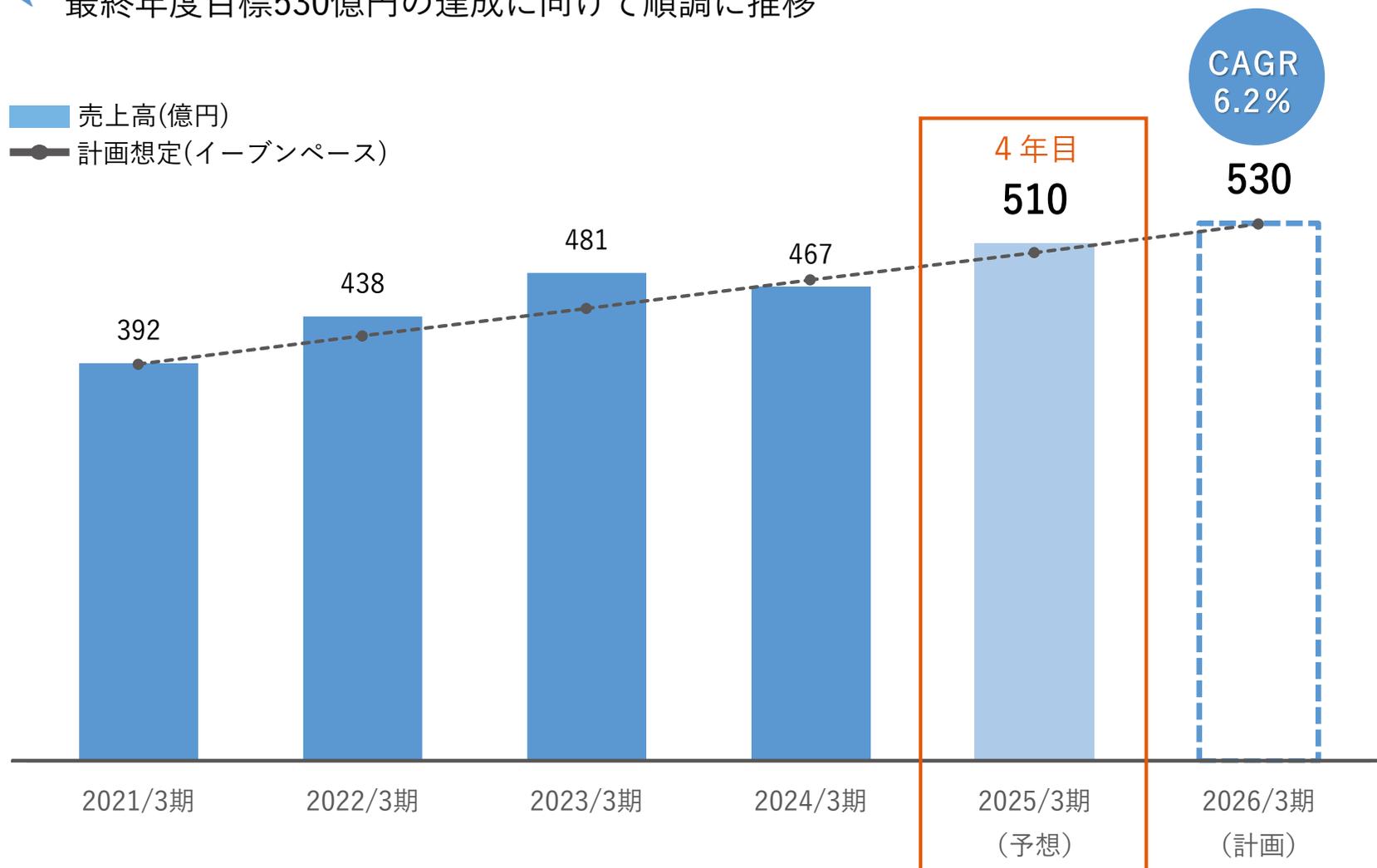
※純資産配当率 = 1株当たり配当金 / 期中平均1株当たり純資産 (= ROE × 配当性向)



3. 中期経営計画の進捗状況

中期経営計画（売上高）の進捗状況

POINT 2025年3月期の売上予想は計画をやや上回るペース
最終年度目標530億円の達成に向けて順調に推移

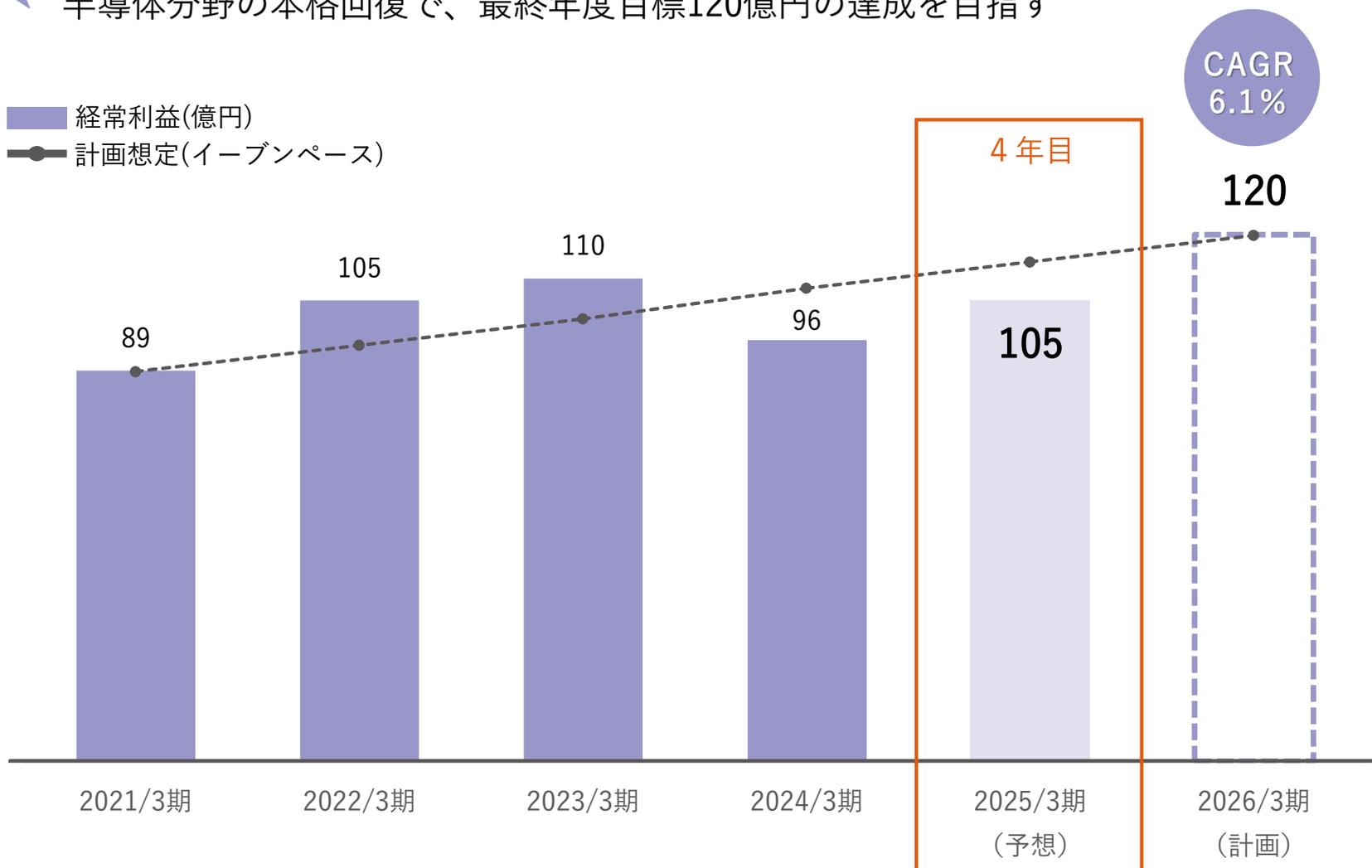


中期経営計画（経常利益）の進捗状況



2025年3月期の経常利益予想は計画に対して遅れ

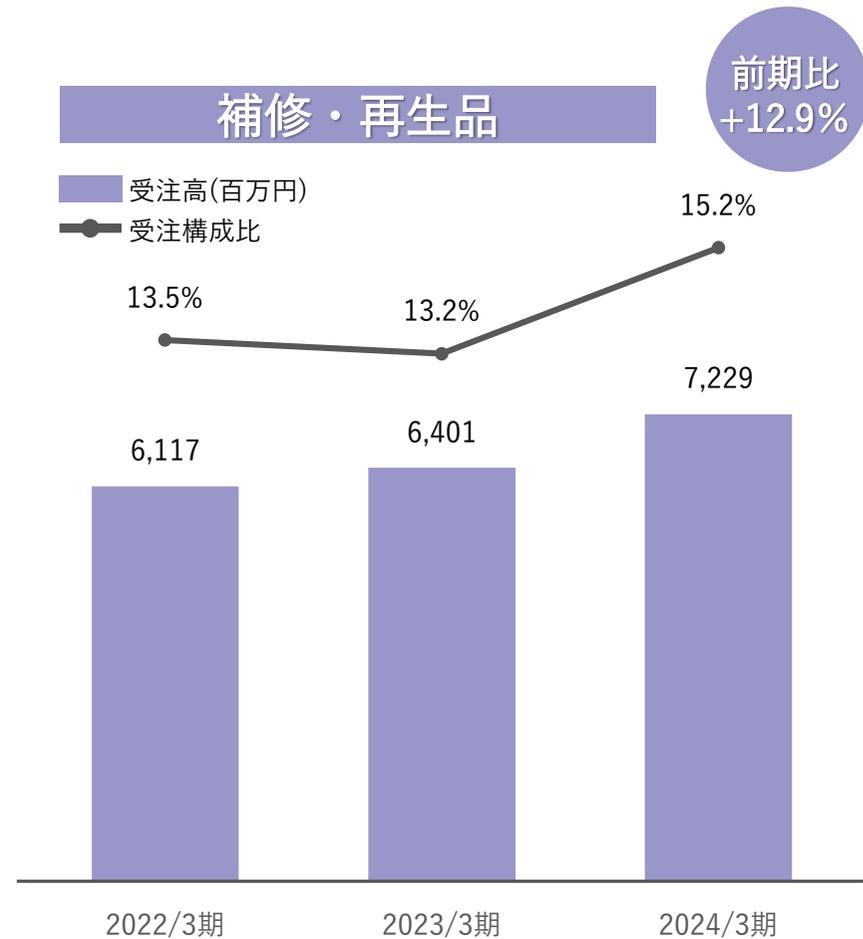
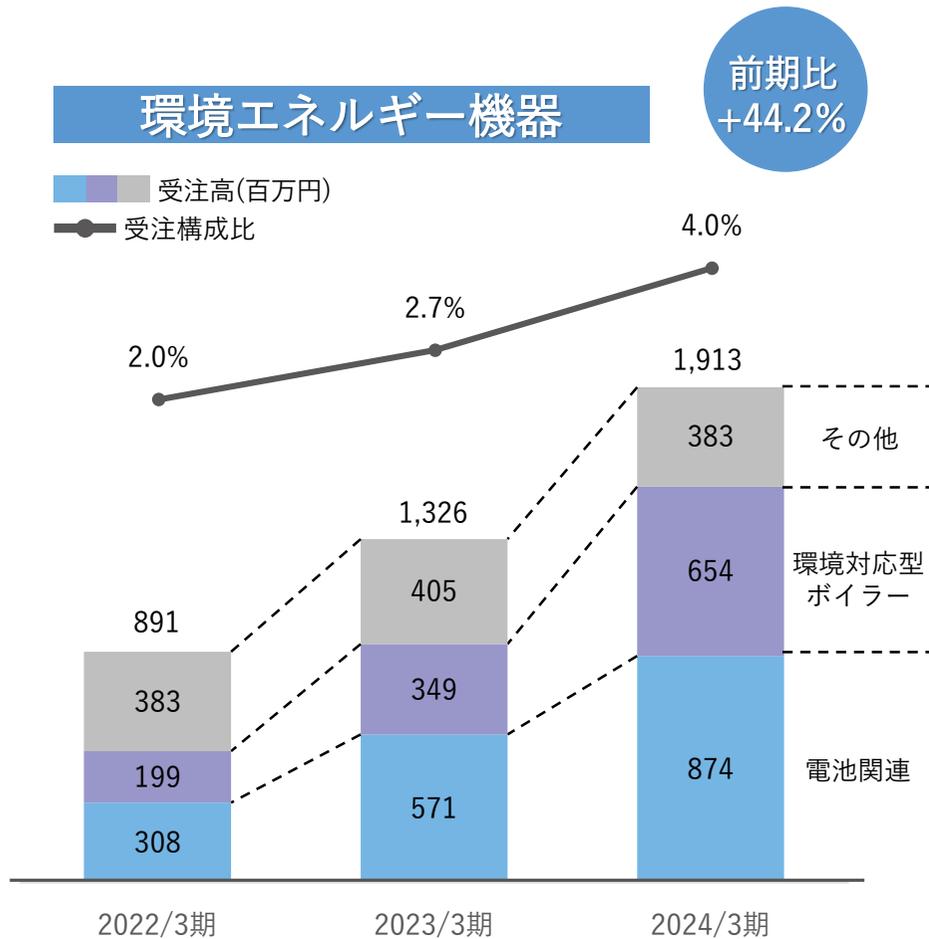
半導体分野の本格回復で、最終年度目標120億円の達成を目指す



環境分野の受注推移

POINT 電池関連機器や環境対応型ボイラーなどの加工が大きく伸長

POINT 顧客の設備部品等を補修・再生するための加工も順調に成長





4. 資本コストや株価を意識した 経営の実現について

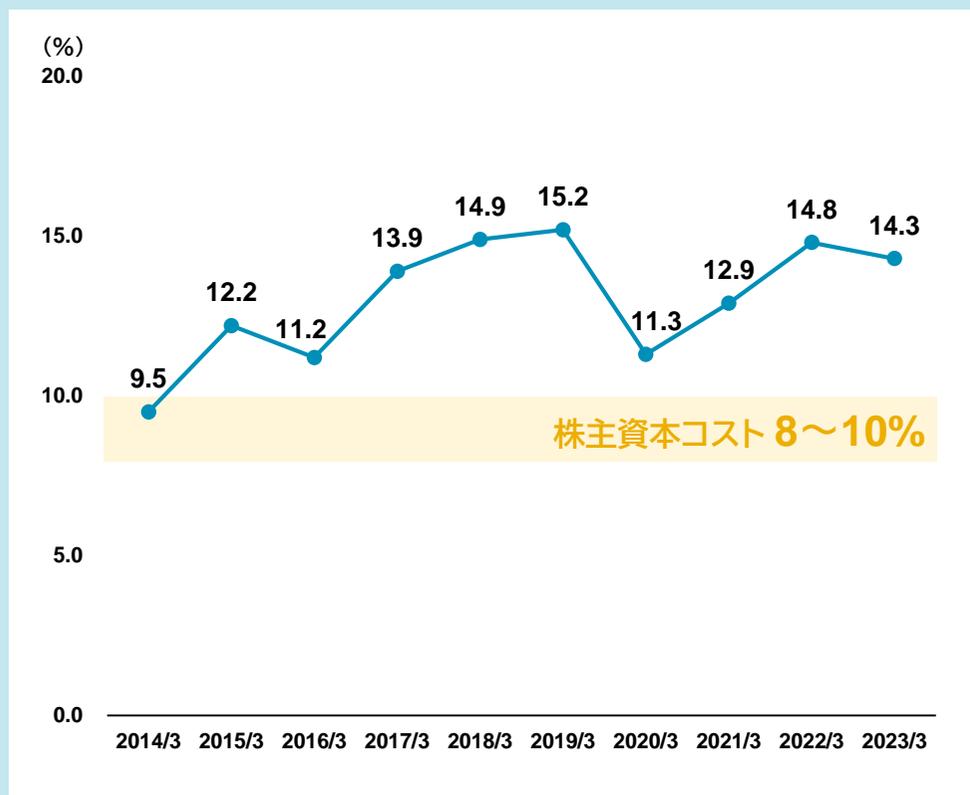
直近9年間のROEが株主資本コストを上回っていることから、相応の資本収益性を維持できているものと認識。その結果として一定の市場評価を獲得し、過去10年間のPBRは1倍を超える水準で推移

当社の株主資本コスト

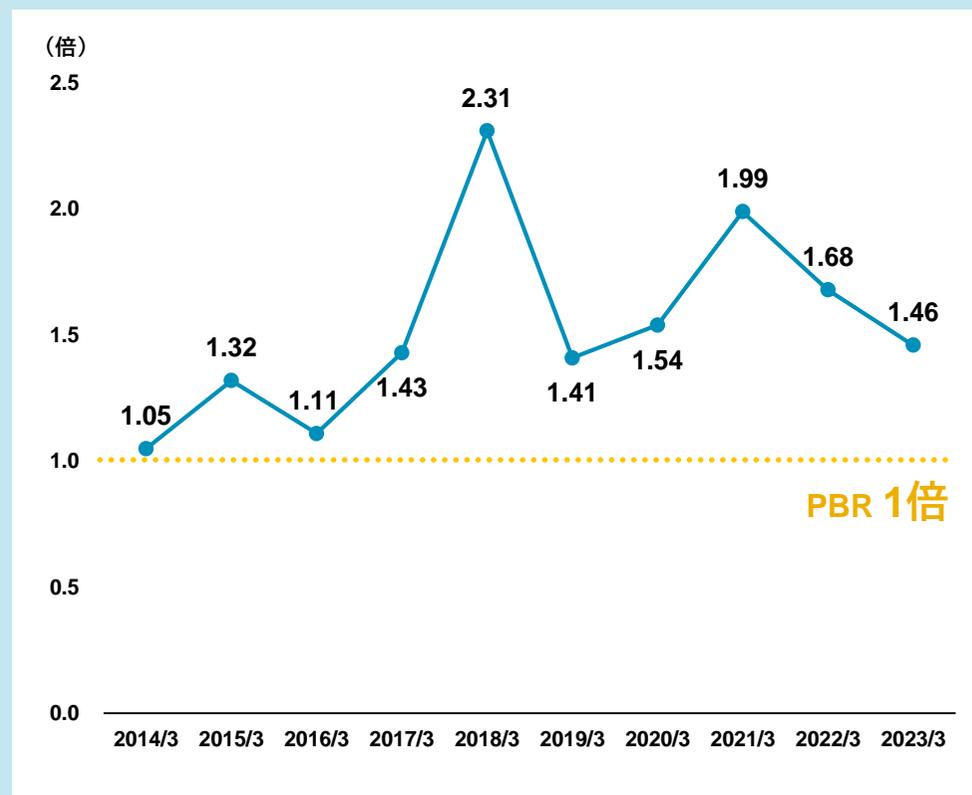
(参考値)
8~10%程度

一般的に妥当とされている計算方法によって証券会社各社が当社向けに試算した数値や、証券アナリストが算出した当社の期待収益率を総合的に勘案し、当社に要求されている株主資本コストは8~10%程度と認識

● ROEの推移

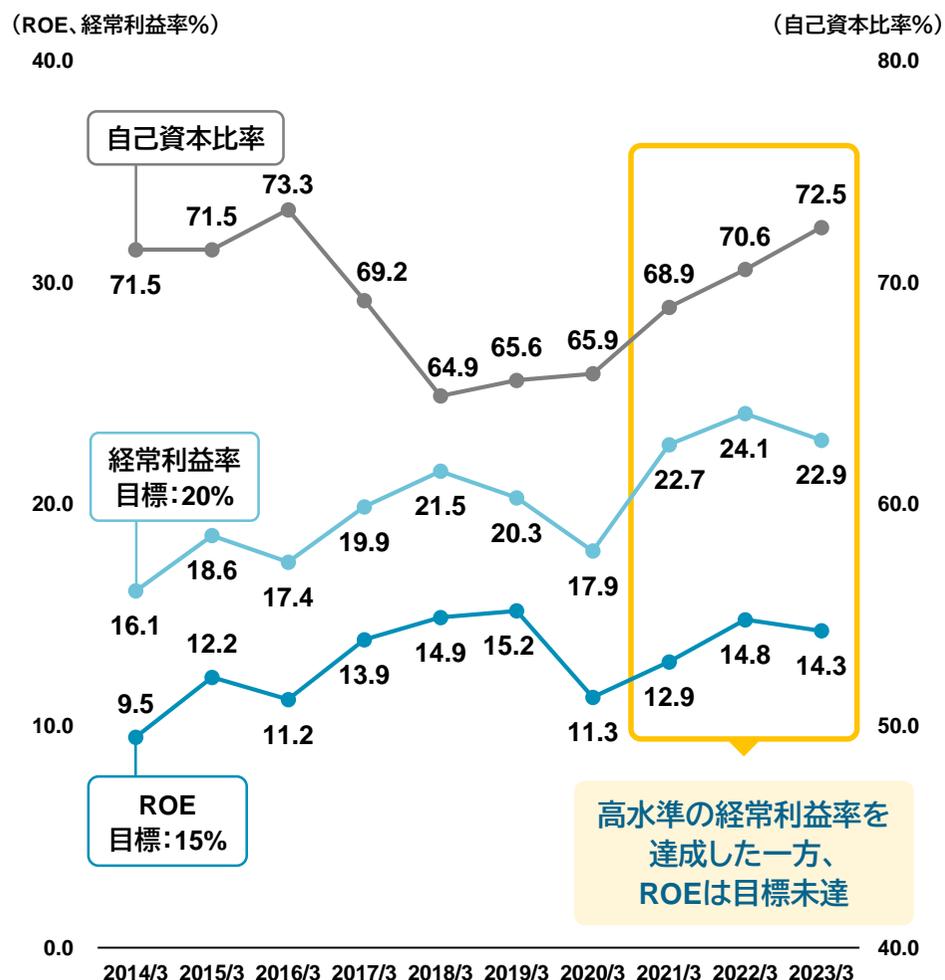


● PBRの推移

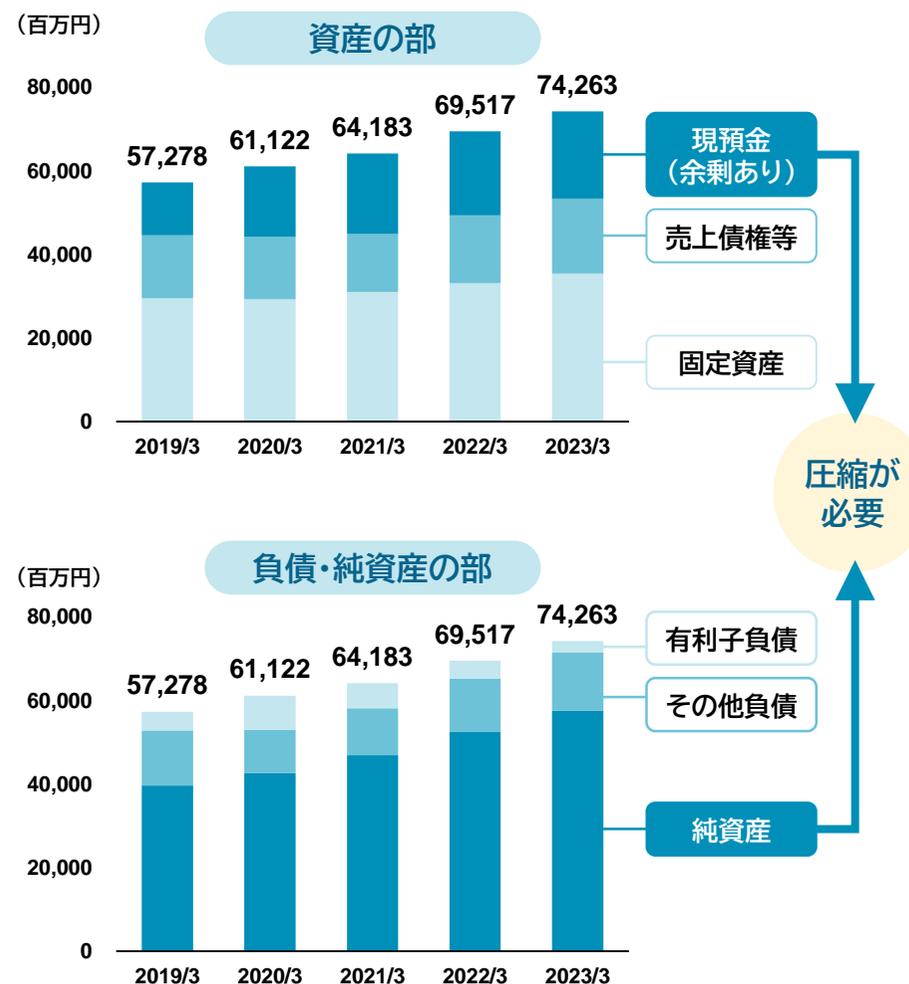


PBRは安定的に1倍以上を維持できているものの、順調な業績進展により自己資本が積み上がった影響で、ROEは目標未達となっている。今後は資本効率向上のため、保有資産に対する積極的な施策が求められる

重要指標の推移



バランスシートの状況



株主資本価値をさらに高めるため、3つの施策を通じてROE15%の安定的な達成を図る

目標

ROE15%を安定的に達成する

対応策

1 収益力の向上

- **溶射を中心とする表面改質のトップメーカーとして存在感を発揮**
既存市場に頼ることなく、新皮膜の開発や新市場を創出することで事業拡大を図る
- **品質管理の強化と生産性の向上**
自動化・IoT化の推進、新規成膜装置の開発等により、製造プロセスを高度化・効率化
- **技術優位性の確保と収益性の向上**
設備投資(年間50~70億円)と開発投資(売上高比率5%程度)を継続的に実施

2 現預金水準の最適化

- **現預金水準を段階的に引き下げ**
生産増強や技術開発への積極投資を支える強い財務体質は維持しつつも、今後は資本効率の向上を図るため、最適な現預金水準を追求。営業CF+余剰現預金を原資として、成長投資(設備投資、開発投資、人的資本投資、M&A等)と利益配当へ積極的に配分し、残りの原資について喫緊の資金需要がない場合は追加的な株主還元も検討

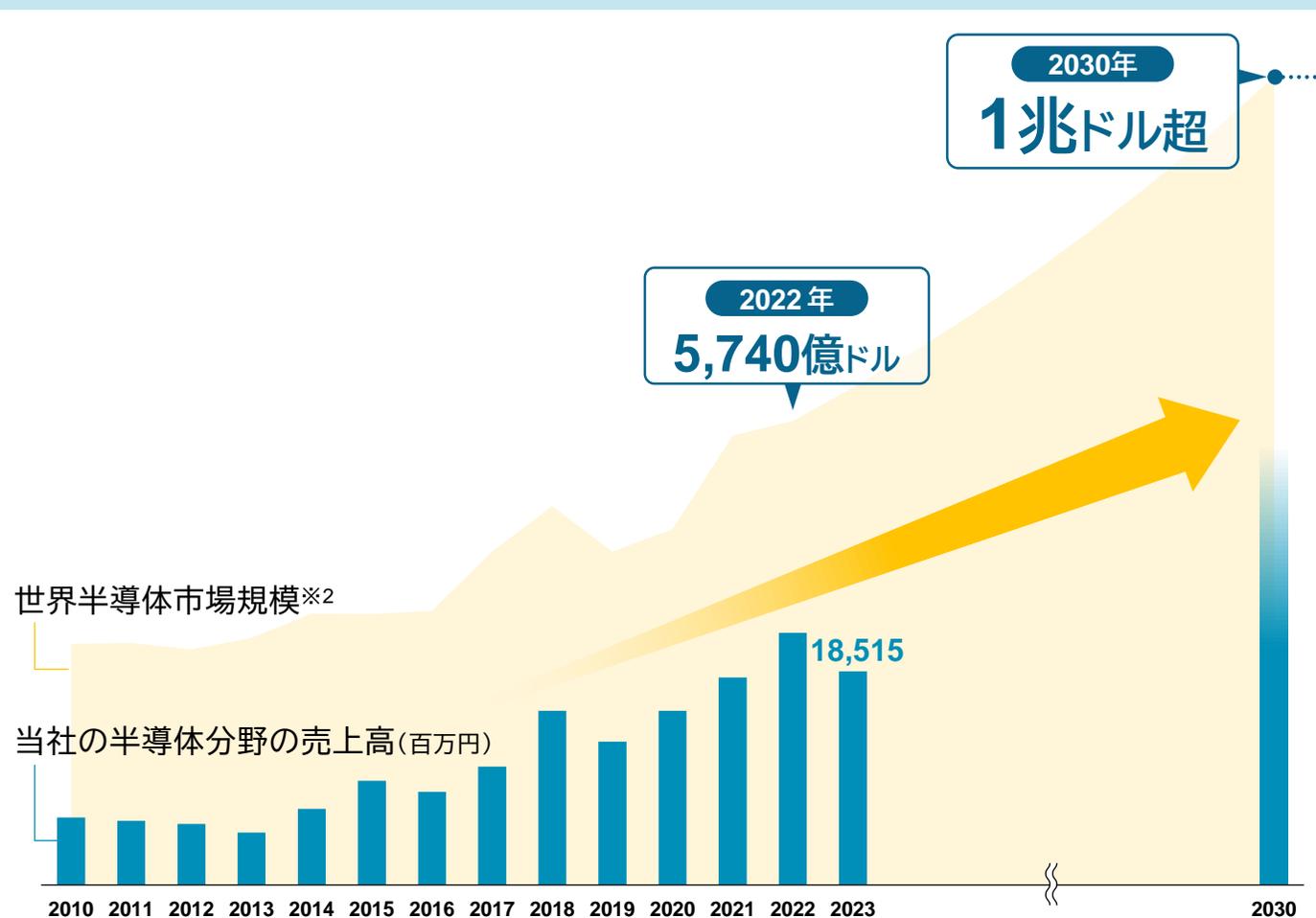
3 株主還元の強化

- **高水準かつ安定的な配当を継続**
連結配当性向50%程度(2023年3月期実績:41.4%)、純資産配当率(DOE)5%以上を目標とする
- **自己株式の取得も機動的に検討**

① 収益力の向上 (1/3 半導体分野の成長)

半導体分野※1においては、国内トップシェアの強みを活かし、市場拡大を事業成長に転換していく。また設備投資や開発投資を継続的に実施することで、半導体技術の進化に対応した新たなソリューションの展開を目指す

● 半導体市場規模と当社売上高の推移



市場は約**2倍**に成長
(2022→2030年)

生成AIや自動運転、EVなどの
需要拡大を追い風に

事業成長を実現

市場拡大に伴って
半導体技術も**進化**

既存領域にとどまることなく、
積極的な投資・開発によって

新規領域を開拓

高度な
テクノロジーを支える

※1 半導体製造装置部品に、発塵防止(耐プラズマ)や静電吸着の機能を付与する加工
※2 一般社団法人電子情報技術産業協会 世界半導体市場統計(WSTS)をもとに当社作成

半導体に次ぐ市場として、環境・エネルギー分野の開拓を進めることで事業拡大を図る。顧客(製造業)のニーズとして、環境負荷低減や省エネなどへの対応の重要性が高まるなか、当社の保有技術で顧客に高付加価値を提供する

表面改質※の機能

- 耐食性
- 耐摩耗性
- 環境遮断性
- 耐酸化性
- 遮熱性
- 耐プラズマ性
- 通電性・電気絶縁性
- センシング性
- 耐焼き付き性
- 潤滑性、グリップ性
- 保油性 等

マッチング

顧客のニーズ

- 生産性の向上
- 製品品質の向上
- 環境・社会課題への対応
 - 環境負荷低減
 - 省エネ
 - 安全衛生

人と自然の豊かな未来へ貢献

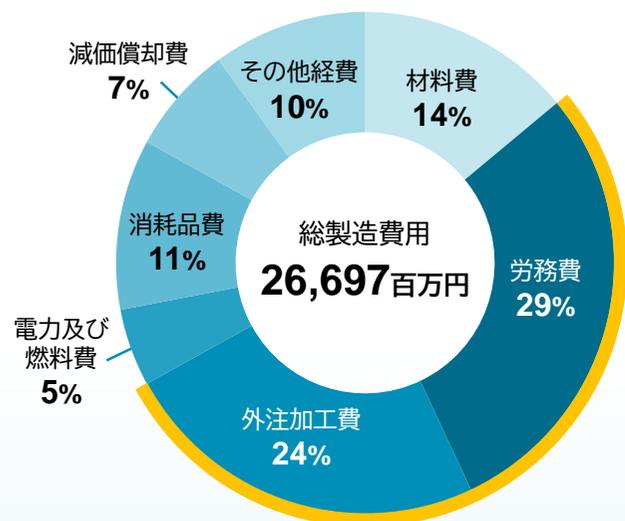
※ 様々な製品や生産設備に機能材料のコーティングや加工を施すことで、新たな性質や機能を与える技術

当社の表面改質加工は労働集約型である一方、オーダーメイド仕様が多く完全自動化との親和性は低い。そのため、収益力の向上を実現するには、効果が期待できる適切な製造プロセスに対して高度化・効率化を進めることが必要

● 当社の表面改質加工の特徴

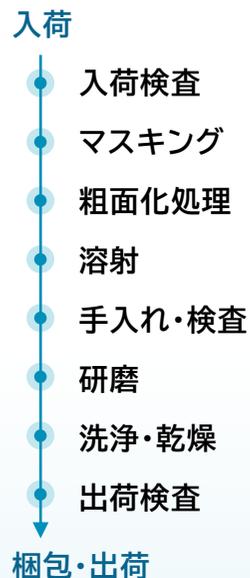
労働集約型の業務構造

製造費用の内訳(2023年3月期/単体)



労務費と外注加工費が過半を占める

溶射工程(一例)



顧客ごとのオーダーメイド業務

顧客の要望に応じた
カスタム仕様

多品種・少量生産

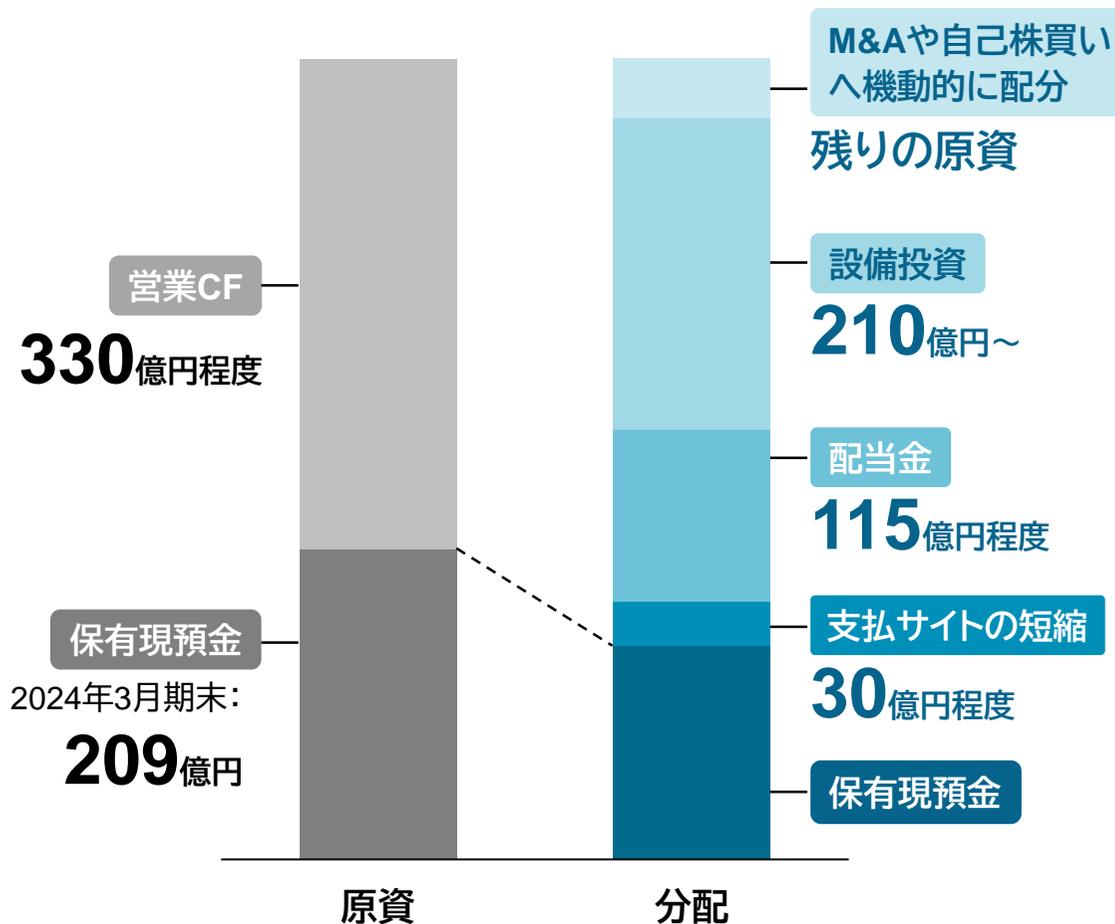
完全に自動化することは
難しい

改善可能な業務をしっかりと見極め、自動化・IoT化によって人への依存を低減。
生産性の向上とともに品質管理の強化を図る

② 現預金水準の最適化

資本効率の向上を図るため、最適な現預金水準を追求。営業CF + 余剰現預金を原資として成長投資と利益配当へ積極的に配分し、残りの原資について喫緊の資金需要がない場合は追加的な株主還元も検討

● キャピタル・アロケーション方針（2025/3期～2027/3期）



機動的な投資を可能にする
キャッシュは手元資金として不可欠。

最適な現預金水準を

段階的に見極めていく



安定した財務体質と
高水準なROEのバランス

— 2025/3期～2027/3期の主な設備投資（予測）

今後も市場の伸びが予測される半導体・FPD分野の拡大を主眼に置き、①新工場の建設、②先端設備の導入、③研究設備の導入の3本立ての設備投資を実行する

① 新工場の建設

神戸工場の新工場棟
(兵庫県神戸市)

13億円

半導体・医療分野などで、その他表面処理の適用拡大と生産効率化を図る
2024年5月着工、2025年3月竣工予定

鈴身事業所の新工場棟
(千葉県船橋市)

56億円

半導体製造装置メーカーからの受注増加を見据え、増産体制を整える
2024年8月着工、2026年4月竣工予定、設備導入や顧客認証を経て2027年初頭稼働

北九州工場の新工場棟
(福岡県京都郡)

32億円

半導体製造装置メーカーからの受注増加を見据え、増産体制を整える
2024年12月着工、2026年7月竣工予定、設備導入や顧客認証を経て2027年春頃稼働

② 先端設備の導入

自動化・省人化や高機能化
を企図した先端設備

12億円

自動化・省人化等を実現する先端設備の導入により、生産性向上と品質管理の強化を図る

③ 研究設備の導入

次世代技術開発のための
研究装置、測定・評価設備

10億円

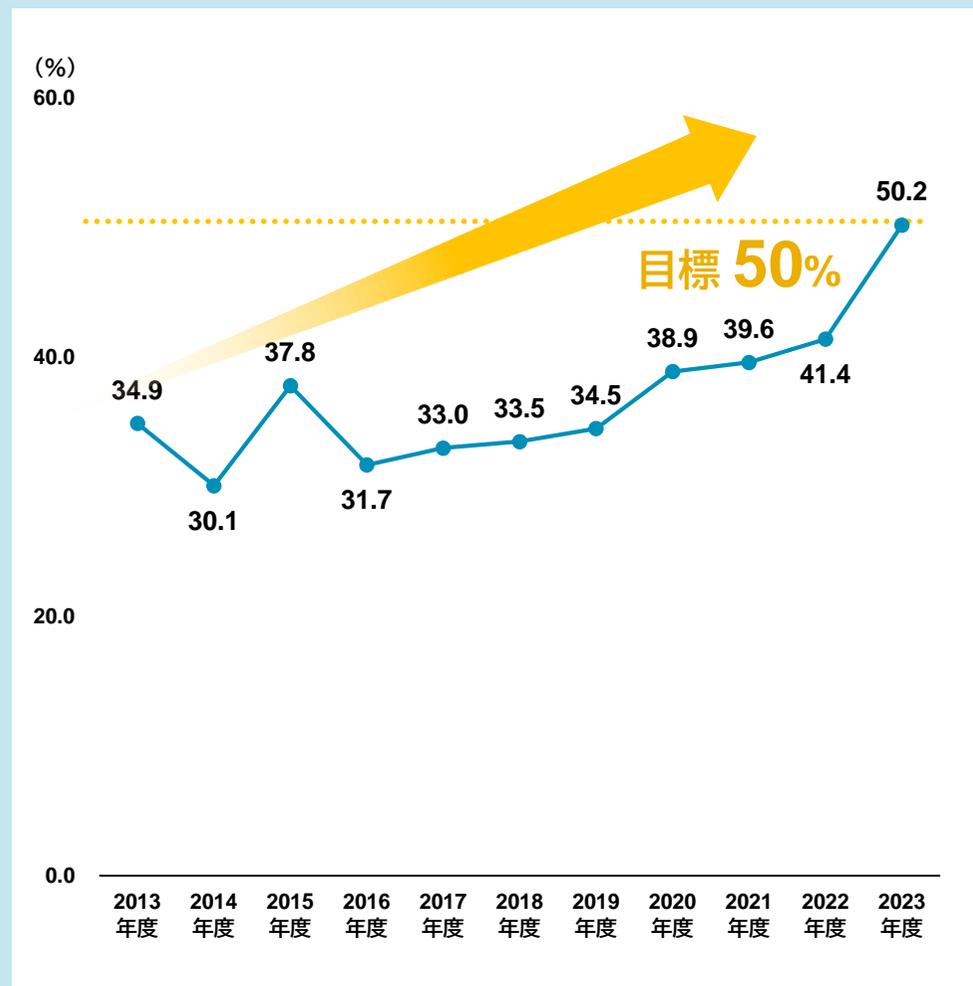
半導体の微細化・多層化への対応をはじめ、新事業領域の開拓に向けた次世代皮膜開発のための研究設備等を導入する

(注) 更新投資等は含んでおりません。

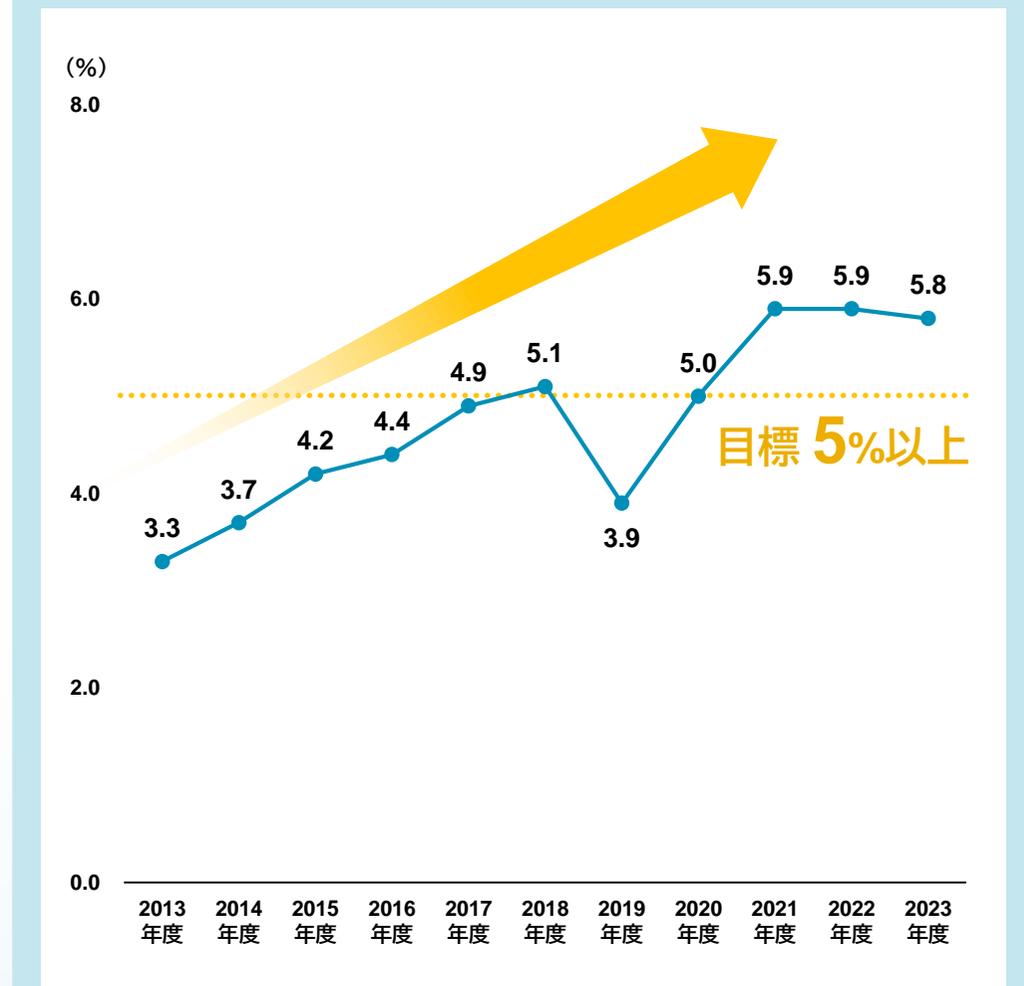
③ 株主還元強化

連結配当性向50%程度(2023年3月期実績:41.4%)、純資産配当率(DOE)5%以上を目標とし、高水準かつ安定的な利益配当を図る。また自己株式の取得についても、機動的に実施を検討

● 連結配当性向の推移



● DOEの推移



経営指標ハイライト

(百万円)	2020/3期 実績	2021/3期 実績	2022/3期 実績	2023/3期 実績	2024/3期 実績	2025/3期 予想
受注高	38,011	39,021	45,394	48,419	47,505	—
受注残高	6,195	6,143	7,896	8,349	9,260	—
売上高	38,084	39,294	43,813	48,144	46,735	51,000
営業利益	6,727	8,890	10,255	10,558	9,197	10,500
経常利益	6,812	8,914	10,571	11,003	9,662	10,500
経常利益率	17.9%	22.7%	24.1%	22.9%	20.7%	20.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	4,404	5,463	6,909	7,350	6,326	6,880
1株当たり当期純利益 (EPS)	72.45円	89.86円	113.62円	120.83円	105.53円	115.75円
総資産	61,122	64,183	69,517	74,263	77,940	83,100
自己資本	40,263	44,201	49,099	53,839	55,460	59,000
自己資本比率	65.9%	68.9%	70.6%	72.5%	71.2%	71.0%
自己資本利益率 (ROE)	11.3%	12.9%	14.8%	14.3%	11.6%	12.0%
総資産経常利益率 (ROA)	11.5%	14.2%	15.8%	15.3%	12.7%	13.0%
投下資本利益率 (ROIC)	9.8%	11.9%	13.0%	12.5%	10.2%	11.0%

(注) ROE=親会社株主に帰属する当期純利益÷期中平均自己資本、ROA=経常利益÷期中平均総資産、ROIC=税引後営業利益÷期中平均投下資本

売上高及び営業利益は、2022/3期の表示方法の変更(「受取ロイヤリティー等」の計上区分を営業外収益から売上高に変更)を反映した組替え後の数値です。

注意事項

本資料における将来に関する記述は、発表日現在、当社が入手可能な情報に基づいて判断したものであり、今後のさまざまな要因により、実際の業績等はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

お問い合わせ先

トーカロ株式会社

経営企画部

TEL: 078-303-3433 (代)